

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-133750

(P2001-133750A)

(43) 公開日 平成13年5月18日 (2001.5.18)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ト (参考)
G 0 2 F 1/133	5 5 0	G 0 2 F 1/133	5 5 0
	1/1333		5 0 5
	1/1335		5 0 0
	1/1368	G 0 9 F 9/30	3 3 8
G 0 9 F 9/30	3 3 8	G 0 9 G 3/20	6 2 1 B

審査請求 未請求 請求項の数47 O L (全 30 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-191259(P2000-191259)

(22) 出願日 平成12年6月26日 (2000.6.26)

(31) 優先権主張番号 特願平11-234584

(32) 優先日 平成11年8月20日 (1999.8.20)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(31) 優先権主張番号 特願平11-234585

(32) 優先日 平成11年8月20日 (1999.8.20)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72) 発明者 村出 正夫

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

(74) 代理人 100093388

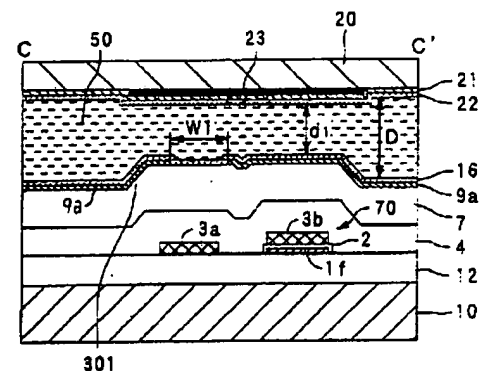
弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

(54) 【発明の名称】 電気光学装置

(57) 【要約】

【課題】 液晶装置等の電気光学装置において、液晶等に面する基板上表面の段差に起因する液晶等の配向不良と横電界による液晶等の配向不良とを低減することで、画素の開口率が高く且つ高コントラスト比で明るい高品位の画像表示を行う。

【解決手段】 TFTアレ基板(10)上に画素電極(9a)を備え、対向基板(20)上に対向電極(21)を備える。TFTアレ基板上における画素電極の下地面、あるいは対向基板上における対向電極の下地面は、反転駆動時に相互に逆極性の駆動電圧で駆動される相隣接する画素電極間の間隙に対向する領域で、盛り上がっている。この盛り上部に、相隣接する画素電極の縁が位置する。この下地面は、反転駆動時に相互に同一極性の駆動電圧で駆動される相隣接する画素電極間の間隙に対向する領域では、平坦に形成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質とを有する電気光学装置において、

前記電気光学物質は、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間の前記電気光学物質の層厚を、互いに同じ極性で駆動される隣接した前記画素電極間の前記電気光学物質の層厚より薄くしたことを特徴とする電気光学装置。

【請求項2】 前記画素電極は行あるいは列毎に反転駆動されると共に、反転駆動される前記画素電極の行あるいは列に対して交差する画素電極間の前記電気光学物質の層厚を、前記反転駆動される行あるいは列の画素電極間の前記電気光学物質の層厚より薄くしたことを特徴とする請求項1記載の電気光学装置。

【請求項3】 前記第1基板は、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する部位であって、前記画素電極下に形成された盛り部を有することを特徴とする請求項1記載の電気光学装置。

【請求項4】 前記盛り部は、平坦な前記第1基板上に絶縁層と配線層を積層して形成されることを特徴とする請求項3記載の電気光学装置。

【請求項5】 前記第2基板は、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する部位であって、前記対向電極下に形成された盛り部を有することを特徴とする請求項1記載の電気光学装置。

【請求項6】 前記盛り部は、遮光膜を形成することを特徴とする請求項5記載の電気光学装置。

【請求項7】 前記隣接した各々の画素電極の縁部は、前記盛り部上に位置することを特徴とする請求項3または5記載の電気光学装置。

【請求項8】 前記隣接した各々の画素電極の縁部の幅は、前記第2基板の対向電極と前記画素電極の縁部までの距離とほぼ等しいことを特徴とする請求項7記載の電気光学装置。

【請求項9】 前記隣接した各々の画素電極の縁部の幅は、セルギャップの半分の厚みより長いことを特徴とする請求項7記載の電気光学装置。

【請求項10】 前記盛り部は、少なくとも300nmの厚みを有することを特徴とする請求項7記載の電気光学装置。

【請求項11】 前記電気光学物質はTwisted Nematic液晶からなり、前記盛り部は側面に傾斜面を有し、前記Twisted Nematic液晶のプレティルト角の傾き方向と前記盛り部の傾斜面の傾き方向とが一致することを特徴とする請求項3または5記載の電気光学装置。

【請求項12】 前記電気光学物質はVertically Aligned液晶からなり、前記盛り部は前

記第1基板の平面に対して略垂直な側面を有することを特徴とする請求項3または5記載の電気光学装置。

【請求項13】 前記第1基板は、互いに同じ極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する部位であって、前記電気光学物質側表面に形成された平坦部を有することを特徴とする請求項1記載の電気光学装置。

【請求項14】 前記平坦部は、前記第1基板の表面に溝を形成し、前記溝に対応する領域に配線を設けて形成することを特徴とする請求項13記載の電気光学装置。

【請求項15】 複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質と、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応し、前記第1基板の前記画素電極下に形成された盛り部とを具備すること特徴とする電気光学装置。

【請求項16】 複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質と、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応し、前記第2基板の前記対向電極下に形成された盛り部とを具備すること特徴とする電気光学装置。

【請求項17】 複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質と、互いに同じ極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応し、前記第1基板の前記電気光学物質側表面に形成された平坦部とを具備すること特徴とする電気光学装置。

【請求項18】 複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子とを有する素子基板と、

前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、

前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、

前記素子基板の前記データ線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された平坦部と、

前記素子基板の前記走査線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された盛り部とを備え、

前記走査線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動されることを特徴とする電気光学装置。

【請求項19】 さらに、前記走査線に沿う容量線を備えると共に、前記盛り部は前記容量線の領域に形成されることを特徴とする請求項18記載の電気光学装置。

【請求項20】 前記容量線は、前記走査線と同層で形

成されることを特徴とする請求項 1 9 記載の電気光学装置。

【請求項 2 1】 前記容量線は、前記走査線の領域上に絶縁膜を介して形成されることを特徴とする請求項 1 9 記載の電気光学装置。

【請求項 2 2】 前記盛上り部は、頂上付近が平坦に形成されることを特徴とする請求項 1 8 記載の電気光学装置。

【請求項 2 3】 前記平坦部は、前記素子基板の前記データ線に沿った領域に溝を形成して構成されることを特徴とする請求項 1 8 記載の電気光学装置。

【請求項 2 4】 複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、

前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、

前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、

前記素子基板の前記データ線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された盛上り部と、

前記素子基板の前記走査線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された平坦部とを備え、

前記データ線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動されることを特徴とする電気光学装置。

【請求項 2 5】 さらに、前記走査線に沿う容量線を備え、前記平坦部は前記容量線の領域に形成されていることを特徴とする請求項 2 4 記載の電気光学装置。

【請求項 2 6】 前記容量線は、前記走査線と同層で形成されることを特徴とする請求項 2 5 記載の電気光学装置。

【請求項 2 7】 前記容量線は、前記走査線の領域上に絶縁膜を介して形成されることを特徴とする請求項 2 5 記載の電気光学装置。

【請求項 2 8】 前記盛上り部は、頂上付近が平坦に形成されることを特徴とする請求項 2 4 記載の電気光学装置。

【請求項 2 9】 前記平坦部は、前記素子基板の前記走査線及び前記容量線に沿った領域の少なくとも一部に溝を形成して構成されることを特徴とする請求項 2 5 記載の電気光学装置。

【請求項 3 0】 複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、

前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基

板と、

前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、

前記素子基板の前記データ線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された平坦部と、

前記素子基板の前記走査線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された盛上り部とを備え、

前記走査線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動されることを特徴とする電気光学装置。

【請求項 3 1】 さらに、前記走査線に沿う容量線を備え、前記盛上り部は前記容量線の領域に形成されていることを特徴とする請求項 3 0 記載の電気光学装置。

【請求項 3 2】 前記容量線は、前記走査線と同層で形成されることを特徴とする請求項 3 1 記載の電気光学装置。

【請求項 3 3】 前記容量線は、前記走査線の領域上に絶縁膜を介して形成されることを特徴とする請求項 3 1 記載の電気光学装置。

【請求項 3 4】 前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記データ線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることを特徴とする請求項 3 0 記載の電気光学装置。

【請求項 3 5】 前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記走査線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることを特徴とする請求項 3 0 記載の電気光学装置。

【請求項 3 6】 複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、

前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、

前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、

前記素子基板の前記データ線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された盛上り部と、

前記素子基板の前記走査線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された平坦部とを備え、

前記データ線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動されることを特徴とする電気光学装置。

【請求項 3 7】 さらに、前記走査線に沿う容量線を備え、前記盛上り部は前記容量線の領域に形成されていることを特徴とする請求項 3 6 記載の電気光学装置。

【請求項 3 8】 前記容量線は、前記走査線と同層で形

成されることを特徴とする請求項37記載の電気光学装置。

【請求項39】 前記容量線は、前記走査線の領域上に絶縁膜を介して形成されることを特徴とする請求項37記載の電気光学装置。

【請求項40】 前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記データ線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることを特徴とする請求項36記載の電気光学装置。

【請求項41】 前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記走査線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることを特徴とする請求項36記載の電気光学装置。

【請求項42】 複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されたマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、

前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、

前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、

前記素子基板の電気光学物質側表面と前記対向基板の電気光学物質側表面に少なくとも部分的に形成された盛上り部と、を備えたことを特徴とする電気光学装置。

【請求項43】 前記盛上り部は、前記素子基板上の横電界発生領域に形成されることを特徴とする請求項42記載の電気光学装置。

【請求項44】 前記盛上り部は、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する領域に形成されることを特徴とする請求項42記載の電気光学装置。

【請求項45】 前記素子基板側の盛り上がり部と、前記対向基板側の盛り上がり部とは、対向して形成されることを特徴とする請求項42記載の電気光学装置。

【請求項46】 前記素子基板側の盛り上がり部と、前記対向基板側の盛り上がり部は、異なる部位に形成されることを特徴とする請求項42記載の電気光学装置。

【請求項47】 請求項1乃至46のいずれか1つの電気光学装置からなるライトバルブと、投射光学系を備えたことを特徴とするプロジェクタ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、液晶装置等の電気光学装置の技術分野に属し、特に列方向又は行方向に相隣接する画素電極に印加される電圧の極性が逆となるように画素行毎又は画素列毎に電位極性を周期的に反転させる反転駆動方式を採用する薄膜トランジスタ Thin Film Transistor: 以下適宜、TFTと称す) によるアク

ティブマトリクス駆動型の液晶装置等の電気光学装置の技術分野に属する。

【0002】

【従来の技術】 一般に液晶装置等の電気光学装置は、一対の基板間に液晶等の電気光学物質が挟持されており、この電気光学物質の配向状態は、電気光学物質の性質及び基板の電気光学物質側の面上に形成された配向膜により規定されている。従って配向膜の表面に段差があると(即ち、配向膜下にある画素電極の表面或いは画素電極の下地となる層間絶縁膜の表面に段差があると)、この段差の度合いに応じて電気光学物質には配向不良(ディスクリネーション)が生じる。このように配向不良が生じると、この部分では、電気光学物質を良好に駆動することが困難となり、電気光学装置の光抜け等によりコントラスト比が低下してしまう。しかるに、TFTアクティブマトリクス駆動型の電気光学装置の場合には、TFTアレイ基板上に、走査線、データ線、容量線等の各種配線や画素電極をスイッチング制御するためのTFTなどが各所に形成されているため、何らかの平坦化処理を施さなければ、これらの配線や素子の存在に応じて配向膜の表面には必然的に段差が生じてしまう。

【0003】 そこで従来は、このような段差が生じている基板上領域を、相隣接する画素電極間の間隙に対応させると共に、対向基板又はTFTアレイ基板に設けたブラックマスク或いはブラックマトリクスと称される遮光膜により、このように段差が生じている領域(即ち、画素電極間の間隙)を覆い隠すことで、この段差により配向不良を生じる電気光学物質部分については見えないように又は表示光に寄与しないようにしている。

【0004】 或いは従来は、このような各種配線やTFTの存在に起因する段差自体を生じさせないように、画素電極下の層間絶縁膜を例えば有機SOG Spin On Glass) 膜等の平坦化膜から構成して、画素電極の下地面を平坦にする技術も開発されている。

【0005】 他方、一般にこの種の電気光学装置では、直流電圧印加による電気光学物質の劣化防止、表示画像におけるクロストークやフリッカの防止などのために、各画素電極に印加される電位極性を所定規則で反転させる反転駆動方式が採用されている。このうちのフレーム又はフィールドの画像信号に対応する表示を行う間は、奇数行に配列された画素電極を対向電極の電位を基準として正極性の電位で駆動すると共に偶数行に配列された画素電極を対向電極の電位を基準として負極性の電位で駆動し、これに続く次のフレーム又はフィールドの画像信号に対応する表示を行う間は、逆に偶数行に配列された画素電極を正極性の電位で駆動すると共に奇数行に配列された画素電極を負極性の電位で駆動する(即ち、同一行の画素電極を同一極性の電位により駆動しつつ、係る電位極性を行毎にフレーム又はフィールド周期で反転させる) 1H反転駆動方式が、制御が比較的容易

であり高品位の画像表示を可能ならしめる反転駆動方式として用いられている。また、同一列の画素電極を同一極性の電位により駆動しつつ、係る電位極性を列毎にフレーム又はフィールド周期で反転させる1S反転駆動方式も、制御が比較的容易であり高品位の画像表示を可能ならしめる反転駆動方式として用いられている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述した段差を遮光膜により覆い隠す技術によれば、段差のある領域の広さに応じて画素の開口領域が狭くなってしまうため、限られた画像表示領域内において、画素の開口率を高めて、より明るい画像表示を行うという当該電気光学装置の技術分野における基本的な要請を満たすことは困難である。特に、高精細な画像表示を行うための画素ピッチの微細化に伴って単位面積当たりの配線数やTFT数が増加するが、これらの配線やTFTの微細化に一定の限度があることに起因して、画像表示領域内において段差の有る領域が占める割合が相対的に高くなるため、この問題は電気光学装置の高精細化が進む程深刻化してしまう。

【0007】他方、前述した画素電極下の層間絶縁膜を平坦化する技術によれば、TFTアレイ基板上において相隣接する画素電極が同一極性の場合には、特に問題は生じないが、前述した1H反転駆動方式や1S反転駆動方式のように、これらの電圧（即ち、1H反転駆動方式では列方向に相隣接する画素電極に印加される電圧又は1S反転駆動方式では行方向に相隣接する画素電極に印加される電圧）の位相が逆極性にある場合には、平坦化により画素電極と対向電極との間隔が、配線やTFTの上方に位置する画素電極の縁付近において、平坦化しない場合よりも広くなるため、相隣接する画素電極間に生じる横電界（即ち、基板面に平行な電界或いは基板面に平行な成分を含む斜めの電界）が相対的に増加してしまうという問題点が生じる。相対向する画素電極と対向電極との間の縦電界（即ち、基板面に垂直な方向の電界）の印加が想定されている電気光学物質に対して、このような横電界が印加されると、電気光学物質の配向不良が生じ、この部分における光抜け等が発生してコントラスト比が低下してしまうという問題が生じる。これに対し、横電界が生じる領域を遮光膜により覆い隠すことは可能であるが、これでは横電界が生じる領域の広さに応じて画素の開口領域が狭くなってしまうという問題点が生じる。特に、画素ピッチの微細化により相隣接する画素電極間の距離が縮まるのに伴って、このような横電界は大きくなるため、これらの問題は電気光学装置の高精細化が進む程深刻化してしまう。

【0008】本発明は上述した問題点に鑑みなされたものであり、液晶等の電気光学物質に面する基板上表面の段差に起因する電気光学物質の配向不良と横電界による電気光学物質の配向不良とを総合的に低減することによ

り、画素の開口率が高く且つ高コントラスト比で明るい高品位の画像表示が可能となる液晶装置等の電気光学装置を提供することを課題とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明の第1電気光学装置は上記課題を解決するために、複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質とからなり、前記電気光学物質は、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間の前記電気光学物質の層厚を、互いに同じ極性で駆動される隣接した前記画素電極間の前記電気光学物質の層厚より薄くしたことを特徴とする。

【0010】また、本発明の第1電気光学装置は、複数の画素電極は行あるいは列毎に反転駆動される。そして、反転駆動される行あるいは列に対して交差する画素電極間の前記電気光学物質の層厚を、前記反転駆動される行あるいは列の画素電極間の前記電気光学物質の層厚より薄くしたことを特徴とする。

【0011】この反転駆動として、例えば、1H反転駆動方式や1S反転駆動方式が有効である。

【0012】以上の構成によれば、互いに異なる極性で駆動される隣接した画素電極間の電気光学物質の層厚が薄いので、画素電極と対向電極との間に発生する縦電界を強めることができる。よって、横電界が発生する領域において、横電界に対して縦電界を相対的に強くでき、横電界による電気光学物質の配向不良の発生を低減することができる。

【0013】また、本発明の第1電気光学装置は、前記第1基板に、互いに異なる極性で駆動される隣接した画素電極間に対応する部位であって、前記画素電極下に形成された盛り上り部を有することを特徴とする。

【0014】あるいは、前記第2基板に、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する部位であって、前記対向電極下に形成された盛り上り部を有することを特徴とする。

【0015】第1基板に形成される盛り上がり部は、平坦な前記第1基板上に絶縁層と配線層を積層して形成されるとよい。

【0016】また、第2基板に形成される盛り上り部は、遮光膜を形成してもよい。

【0017】盛り上り部は、土手状に形成され、その長手軸に垂直に切った断面形状としては、例えば、台形、三角形、半円形等の各種の形状が考えられる。

【0018】また、盛り上り部を形成するのに、配線や薄膜トランジスタを形成する導電膜や層間絶縁膜等を利用したり、積層プロセス中に第1基板と画素電極との間に盛り上り部形成用の膜を局所的に追加形成してもよい。

【0019】また、液晶等の電気光学装置の性質に応じて生じる電気光学物質の配向不良が小さくて済むような

断面形状であれば、盛上り部分において部分的に電気光学物質の層厚が厚くなるものであっても、本発明の趣旨を妨げないものである。

【0020】また、隣接した各々の画素電極の縁部は、盛上り部上に位置するとよい。

【0021】この場合、隣接した各々の画素電極の縁部の幅は、第2基板の対向電極と画素電極の縁部までの距離とほぼ等しいことが望ましい。

【0022】また、前記隣接した各々の画素電極の縁部の幅は、セルギャップの半分の厚みより長いことが望ましい。

【0023】この態様によれば、横電界による悪影響が実用上表面化しない程度にまで、縦電界を横電界に対して大きくできる。したがって、電気光学物質の層厚を薄くすること無しに画素電極の間隔を狭めることができるため、画素ピッチが微細になっても開口率が維持できるばかりでなく電気光学物質の層厚を制御することが出来る。

【0024】また、盛上り部の厚みは、少なくとも300nmの厚みを有することが望ましい。

【0025】この態様によれば、横電界が生じる領域では縦電界は膜厚が小さくなるのに応じて強められるが、画素電極群とが隣り合う領域では、段差が300nm以上となるまで盛り上げられているため、膜厚はこれに応じて小さくなり、横電界による悪影響が実用上表面化しない程度にまで、この領域における縦電界を横電界に対して大きくできる。

【0026】また、電気光学物質がTN (Twisted Nematic) 液晶からなる場合、盛上り部は、側面に傾斜面を備え、前記TN液晶のプレティルト角の傾き方向と、前記盛上り部の傾斜面の傾き方向とを一致させることが望ましい。

【0027】この態様によれば、TN液晶は、電圧無印加状態では各液晶分子が基本的に基板面にほぼ平行な状態で第1基板から第2基板に向けて徐々に捻じれるように配向するため、このように下地面の境界にテーパが付けられていれば、画素電極端におけるTN液晶の層厚が側面に沿って徐々に小さくなくても、画素電極略中心におけるTN液晶の層厚が一定している場合に近い良好な液晶配向状態が得られる。即ち、横電界に起因した液晶配向不良を低減するために層厚が局所的に薄くされた液晶部分で段差により生じる液晶配向不良を極力抑えることができる。

【0028】また、この態様では、TN液晶の第1基板上におけるプレティルト角の傾き方向と盛上り部の傾斜面の傾き方向とが合わせられているので、TN液晶は、電圧無印加状態では各液晶分子が基本的に基板面にほぼ平行な状態であって基板面に対して例えば数度程度のプレティルト角だけ傾いた状態となるように配向する。ここで、このようにテーパの傾き方向と、プレティルト角

の傾き方向とが合わせられていれば、このテーパに沿って画素電極端におけるTN液晶の層厚が側面に沿って徐々に小さくなくても、画素電極のほぼ中心における液晶の層厚が一定している場合に非常に近い良好な液晶配向状態が得られる。尚、ここに“傾き方向が合わせられている”とは、TN液晶の層厚が一定している場合に非常に近い良好な液晶配向状態が得られる程度に、これら両者の傾きが一致していることをいい、その許容範囲は、実験的、経験的及び理論的に適宜定められる。

【0029】また、電気光学物質がVA (Vertically Aligned) 液晶からなる場合、盛上り部は、前記第1基板の平面に対して略垂直な側面を有することが望ましい。

【0030】この態様によれば、VA液晶は、電圧無印加状態では各液晶分子が基本的に基板面にほぼ垂直な状態となるように配向するため、高さの異なる下地面の境界が存在する領域では、液晶配向が乱れざるを得ないが、下地面の境界が垂直に切り立っていれば、係る境界で配向が乱れる液晶部分を極力小さくできる。従って、相対的に高い下地面の頂上付近におけるほぼ平らな個所にある画素電極の部分と、相対的に低い下地面に有る平坦な画素電極の部分との両者で、VA液晶の層厚が一定している場合に近い良好な液晶配向状態が得られる。即ち、横電界に起因した液晶配向不良を低減するために層厚が局所的に薄くされた液晶部分で段差により生じる液晶配向不良を極力抑えることができる。

【0031】また、本発明の第1電気光学装置の第1基板に、互いに同じ極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する部位であって、前記電気光学物質側表面に形成された平坦部を有することを特徴とする。

【0032】この平坦部は、前記第1基板の表面に溝を形成し、前記溝に対応する領域に配線を設けて形成することが望ましい。

【0033】この態様によれば、データ線や走査線等の配線の下方に位置する第1基板や層間絶縁膜にエッチング処理等により溝を掘って、データ線や走査線を埋め込むことにより、この領域における平坦化処理を比較的容易に施すことができる。

【0034】本発明の第2電気光学装置は、複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質と、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応し、前記第1基板の前記画素電極下に形成された盛上り部と、を具備すること特徴とする。

【0035】本発明の第3電気光学装置は、複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質と、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応し、前記第

2基板の前記対向電極下に形成された盛り部と、を具備すること特徴とする。

【0036】本発明の第4電気光学装置は、複数の画素電極を有する第1基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板で挟持された電気光学物質と、互いに同じ極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応し、前記第1基板の前記電気光学物質側表面に形成された平坦部と、を具備すること特徴とする。

【0037】本発明の第5電気光学装置は、複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、前記素子基板の前記データ線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された平坦部と、前記素子基板の前記走査線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された盛り部とを備え、前記走査線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動されることを特徴とする。

【0038】前記盛り部は、前記走査線に沿う容量線の領域に形成してもよい。

【0039】また、前記盛り部は、頂上付近が平坦に形成されとよい。

【0040】前記容量線は、走査線と同層に形成したり、走査線の領域上に絶縁膜を介して形成することができる。

【0041】また、前記平坦部は、前記素子基板の前記データ線に沿った領域に溝を形成して構成されることが望ましい。

【0042】本発明の第6電気光学装置は、複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、前記素子基板の前記データ線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された盛り部と、前記素子基板の前記走査線に沿った領域の電気光学物質側表面に形成された平坦部とを備え、前記データ線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動されることを特徴とする。

【0043】前記平坦部は、前記走査線に沿った容量線の領域に形成してもよい。

【0044】また、前記盛り部は、頂上付近が平坦に

形成されとよい。

【0045】前記容量線は、走査線と同層に形成したり、走査線の領域上に絶縁膜を介して形成することができる。

【0046】また、前記平坦部は、前記素子基板の前記走査線及び前記容量線に沿った領域に溝を形成して構成されることが望ましい。

【0047】本発明の第7電気光学装置は、複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、前記素子基板の前記データ線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された平坦部と、前記素子基板の前記走査線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された盛り部とを備え、前記走査線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動されることを特徴とする。

【0048】前記盛り部は、前記走査線に沿う容量線の領域に形成してもよい。

【0049】前記容量線は、走査線と同層に形成したり、走査線の領域上に絶縁膜を介して形成することができる。

【0050】また、前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記データ線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることが望ましい。

【0051】また、前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記走査線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることが望ましい。

【0052】本発明の第8電気光学装置は、複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、前記素子基板の前記データ線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された盛り部と、前記素子基板の前記走査線に沿った領域に対応する前記対向基板の電気光学物質側表面に形成された平坦部とを備え、前記データ線に沿う方向の画素電極はライン毎に反転駆動されることを特徴とする。

【0053】前記盛り部は、前記走査線に沿う容量線の領域に形成してもよい。

【0054】前記容量線は、走査線と導層に形成したり、走査線の領域上に絶縁膜を介して形成することができる。

【0055】また、前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記データ線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることが望ましい。

【0056】また、前記素子基板は、前記素子基板の表面に前記走査線が延びる領域に対応した溝を形成し、前記素子基板の電気光学物質側表面を平坦にすることが望ましい。

【0057】本発明の第9電気光学装置は、複数本のデータ線と、前記データ線に交差する複数本の走査線と、前記データ線と前記走査線で囲まれた領域に形成されたマトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記データ線と前記走査線に接続され画像信号を前記画素電極に出力するスイッチング素子と、を有する素子基板と、前記画素電極に対向配置された対向電極を有する対向基板と、前記素子基板と前記対向基板との間に設けられた電気光学物質と、前記素子基板の電気光学物質側表面と前記対向基板の電気光学物質側表面に少なくとも部分的に形成された盛上り部とを備えたことを特徴とする。

【0058】前記盛上り部は、前記素子基板上の横電界発生領域に形成されることが望ましい。

【0059】また、前記盛上り部は、互いに異なる極性で駆動される隣接した前記画素電極間に対応する領域に形成されることが望ましい。

【0060】また、前記素子基板側の盛上り部と、前記対向基板側の盛上り部とは、対向して形成してもよいし、各々異なる部位に形成してもよい。

【0061】以上の本発明の電気光学装置によれば、横電界による電気光学物質の配向不良と段差による電気光学物質の配向不良を総合的に低減することが可能となり、電気光学物質の配向不良箇所を隠すための遮光膜も小さくできる。よって、光抜け等の画像不良を起こさずに各画素の開口率を高めることができ、最終的にコントラスト比が高く且つ明るく高品位の画像表示が可能となる。

【0062】そして、本発明のこのような作用及び他の利得は後述する実施例から明らかにされる。

【0063】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。以下の各実施形態は、本発明の電気光学装置を液晶装置に適用したものである。

【0064】（第1実施形態）本発明の第1実施形態における電気光学装置の構成について、図1から図8を参照して説明する。図1は、電気光学装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に形成された複数の画素における各種素子、配線等の等価回路である。図2は、データ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板

の相隣接する複数の画素群の平面図であり、図3は、図2のA-A'断面図であり、図4は、図2のB-B'断面図であり、図5は、図2のC-C'断面図である。また図6は、1H反転駆動方式における各電極における電位極性と横電界が生じる領域とを示す画素電極の図式的平面図であり、図7は、TN液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図であり、図8は、VA液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図である。尚、図3から図5においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならしめてある。

【0065】図1において、第1実施形態における電気光学装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に形成された複数の画素は、画素電極9aと当該画素電極9aを制御するためのTFT30がマトリクス状に複数形成されており、画像信号が供給されるデータ線6aが当該TFT30のソースに電気的に接続されている。データ線6aに書き込む画像信号S1、S2、…、Snは、この順に線順次に供給しても構わないし、相隣接する複数のデータ線6a同士に対して、グループ毎に供給するようにしても良い。また、TFT30のゲートに走査線3aが電気的に接続されており、所定のタイミングで、走査線3aにパルス的に走査信号G1、G2、…、Gmを、この順に線順次で印加するように構成されている。画素電極9aは、TFT30のドレインに電気的に接続されており、スイッチング素子であるTFT30を一定期間だけそのスイッチを閉じることにより、データ線6aから供給される画像信号S1、S2、…、Snを所定のタイミングで書き込む。画素電極9aを介して電気光学物質の一例として液晶に書き込まれた所定レベルの画像信号S1、S2、…、Snは、対向基板（後述する）に形成された対向電極（後述する）との間で一定期間保持される。液晶は、印加される電圧レベルにより分子集合の配向や秩序が変化することにより、光を変調し、階調表示を可能にする。ノーマリーホワイトモードであれば、印加された電圧に応じて液晶部分の入射光の透過光量が減少され、ノーマリーブラックモードであれば、印加された電圧に応じて液晶部分の入射光の透過光量が増加され、全体として電気光学装置からは画像信号に応じたコントラストを持つ光が出射する。ここで、保持された画像信号がリークするのを防ぐために、画素電極9aと対向電極との間に形成される液晶容量と並列に蓄積容量70を付加する。

【0066】第1実施形態では、前述した従来の各種の反転駆動方式のうち、1H反転駆動方式を用いて駆動が行われる（図6参照）。これにより、直流電圧印加による液晶の劣化を避けつつ、フレーム或いはフィールド周期で発生するフリッカや特に縦クロストークの低減された画像表示を行える。

【0067】図2において、電気光学装置のTFTアレイ

イ基板上には、マトリクス状に複数の透明な画素電極9a(点線部9a'により輪郭が示されている)が設けられており、画素電極9aの縦横の境界に各々沿ってデータ線6a、走査線3a及び容量線3bが設けられている。データ線6aは、コンタクトホール5を介して例えばポリシリコン膜からなる半導体層1aのうち後述のソース領域に電気接続されている。画素電極9aは、コンタクトホール8を介して半導体層1aのうち後述のドレイン領域に電気接続されている。また、半導体層1aのうち図中右下がりの斜線領域で示したチャネル領域1a'に対向するように走査線3aが配置されており、走査線3aはゲート電極として機能する。このように、走査線3aとデータ線6aとの交差する個所には夫々、チャネル領域1a'に走査線3aがゲート電極として対向配置された画素スイッチング用TFT30が設けられている。

【0068】容量線3bは、走査線3aに沿ってほぼ直線状に伸びる本線部と、データ線6aと交差する箇所からデータ線6aに沿って図中上方に突出した突出部とを有する。

【0069】第1実施形態では特に、TFTアレ基板10上において各データ線6aや各TFT30を含む各データ線6aに沿った領域(図中太線でその輪郭が示された領域)に溝201が設けられ、ストライプ状の溝を形成している。これにより、データ線6aに対する平坦化処理が施されている。

【0070】次に図3の断面図に示すように、電気光学装置は、透明なTFTアレ基板10と、これに対向配置される透明な対向基板20とを備えている。TFTアレ基板10は、例えば石英基板、ガラス基板、シリコン基板からなり、対向基板20は、例えばガラス基板や石英基板からなる。TFTアレ基板10には、画素電極9aが設けられており、その上側には、ラビング処理等の所定の配向処理が施された配向膜16が設けられている。画素電極9aは例えば、ITO(Indium Tin Oxide)膜などの透明導電性薄膜からなる。また配向膜16は例えば、ポリイミド薄膜などの有機薄膜からなる。

【0071】他方、対向基板20には、その全面に渡って対向電極21が設けられており、その下側には、ラビング処理等の所定の配向処理が施された配向膜22が設けられている。対向電極21は例えば、ITO膜などの透明導電性薄膜からなる。また配向膜22は、ポリイミド薄膜などの有機薄膜からなる。

【0072】TFTアレ基板10には、各画素電極9aに隣接する位置に、各画素電極9aをスイッチング制御する画素スイッチング用TFT30が設けられている。

【0073】対向基板20には、更に図3に示すように、各画素の非開口領域に、一般にブラックマスク或いはブラックマトリクスと称される遮光膜23が設けられ

ている。このため、対向基板20の側から入射光が画素スイッチング用TFT30の半導体層1aのチャネル領域1a'や低濃度ソース領域1b及び低濃度ドレイン領域1cに侵入することはない。更に、遮光膜23は、コントラスト比の向上、カラーフィルタを形成した場合における色材の混色防止などの機能を有する。尚、本実施形態では、A1等からなる遮光性のデータ線6aで、各画素の非開口領域のうちデータ線6aに沿った部分を遮光することにより、各画素の開口領域のうちデータ線6aに沿った輪郭部分を規定してもよいし、このデータ線6aに沿った非開口領域についても冗長的に又は単独で対向基板20に設けられた遮光膜23で遮光するように構成してもよい。

【0074】このように構成され、画素電極9aと対向電極21とが対面するように配置されたTFTアレ基板10と対向基板20との間には、後述のシール材により囲まれた空間に電気光学物質の一例である液晶が封入され、液晶層50が形成される。液晶層50は、画素電極9aからの電界が印加されていない状態で配向膜16及び22により所定の配向状態をとる。液晶層50は、例えば一種又は数種類のネマティック液晶を混合した液晶からなる。シール材は、TFTアレ基板10及び対向基板20をそれらの周辺で貼り合わせるための、例えば光硬化性樹脂や熱硬化性樹脂からなる接着剤であり、両基板間の距離を所定値とするためのガラスファイバー或いはガラスビーズ等のギャップ材が混入されている。

【0075】更に、TFTアレ基板10と複数の画素スイッチング用TFT30との間には、下地絶縁膜12が設けられている。下地絶縁膜12は、TFTアレ基板10の全面に形成されることにより、TFTアレ基板10の表面の研磨時における荒れや、洗浄後に残る汚れ等で画素スイッチング用TFT30の特性の劣化を防止する機能を有する。下地絶縁膜12は、例えば、NSG(ノンドープトシリケートガラス)、PSG(リンシリケートガラス)、BSG(ボロンシリケートガラス)、BPSG(ボロンリンシリケートガラス)などの高絶縁性ガラス又は、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜等からなる。

【0076】第1実施形態では、半導体層1aを高濃度ドレイン領域1eから延設して第1蓄積容量電極1fとし、これに対向する容量線3bの一部を第2蓄積容量電極とし、ゲート絶縁膜を含んだ絶縁薄膜2を走査線3aに対向する位置から延設してこれらの電極間に挟持された誘電体膜とすることにより、蓄積容量70が構成されている。

【0077】図3において、画素スイッチング用TFT30は、LDD(Lightly Doped Drain)構造を有しており、走査線3a、当該走査線3aからの電界によりチャネルが形成される半導体層1aのチャネル領域1a'、走査線3aと半導体層1aとを絶縁するゲート絶

緑膜を含む絶縁薄膜2、データ線6a、半導体層1aの低濃度ソース領域1b及び低濃度ドレイン領域1c、半導体層1aの高濃度ソース領域1d並びに高濃度ドレイン領域1eを備えている。高濃度ドレイン領域1eには、複数の画素電極9aのうちの対応する一つがコンタクトホール8を介して接続されている。また、走査線3a及び容量線3bの上には、高濃度ソース領域1dへ通じるコンタクトホール5及び高濃度ドレイン領域1eへ通じるコンタクトホール8が各々形成された第1層間絶縁膜4が形成されている。更に、データ線6a及び第1層間絶縁膜4の上には、高濃度ドレイン領域1eへのコンタクトホール8が形成された第2層間絶縁膜7が形成されている。前述の画素電極9aは、このように構成された第2層間絶縁膜7の上面に設けられている。

【0078】図4に示すように、図2で左右に相隣接する画素電極9aの間隙に位置する各画素の非開口領域には、データ線6aが設けられており、データ線6aにより各画素の開口領域の輪郭のうちデータ線6aに沿った部分が規定されており、且つデータ線6aにより当該非開口領域における光抜けが防止されている。また、データ線6aの下には、容量線3bの本線部からデータ線6aの下に沿って突出した部分を利用して、蓄積容量70が形成されており、非開口領域の有効利用が図られている。

【0079】図3及び図4に示すように第1実施形態では特に、TFTアレイ基板10上において各データ線6aや各TFT30を含む各データ線6aに沿った領域に、溝201が複数設けられている。これにより、データ線6aに対する平坦化処理が施されている。

【0080】図5に示すように、図2で上下に相隣接する画素電極9aの間隙に位置する各画素の非開口領域には、走査線3a及び容量線3bが設けられており、対向基板20に設けられた遮光膜23により各画素の開口領域の輪郭のうち走査線3aに沿った部分が規定されており、且つ遮光膜23により当該非開口領域における光抜けが防止されている。

【0081】図3及び図5に示すように第1実施形態では特に、TFTアレイ基板10上においてデータ線と交差する領域及びその付近を除いた走査線3aに沿った領域に、溝201は設けられていない。また、図に示すように容量線3bに沿った領域に溝201を設けないようにしても良い。尚、容量線3b領域においては、積層が厚くなる場合は、光透過領域に沿って、少なくとも一部に溝201を設けるようにすると良い。これにより段差による光抜けを防止することが出来る。以上、少なくとも走査線3aに対する平坦化処理は施されておらず、画素電極9aの下地面（第1実施形態では、第2層間絶縁膜7の表面からなる）は、この走査線3a等が配置された画素電極9aの間隙において土手状に盛り上がっており、盛り上り部301が形成されている。そして、画素電

極9aの縁は、この盛り上り部301上に形成されている。

【0082】ここで図6を参照して、第1実施形態で採用する1H反転駆動方式における、相隣接する画素電極9aの電位極性と横電界の発生領域との関係について説明する。

【0083】即ち、図6（a）に示すように、 n （但し、 n は自然数）番目のフィールド或いはフレームの画像信号を表示する期間中には、画素電極9a毎に+又は-で示す液晶駆動電位の極性は反転されず、行毎に同一極性で画素電極9aが駆動される。その後図6（b）に示すように、 $n+1$ 番目のフィールド或いは1フレームの画像信号を表示するに際し、各画素電極9aにおける液晶駆動電位の電位極性は反転され、この $n+1$ 番目のフィールド或いは1フレームの画像信号を表示する期間中には、画素電極9a毎に+又は-で示す液晶駆動電位の極性は反転されず、行毎に同一極性で画素電極9aが駆動される。そして、図6（a）及び図6（b）に示した状態が、1フィールド又は1フレームの周期で繰り返されて、1H反転駆動方式による駆動が行われる。この結果、直流電圧印加による液晶の劣化を避けつつ、クロストークやフリッカの低減された画像表示を行える。尚、1H反転駆動方式によれば、1S反転駆動方式と比べて、縦方向のクロストークが殆ど無い点で有利である。

【0084】図6（a）及び図6（b）から分かるように、1H反転駆動方式では、横電界の発生領域C1は常時、縦方向（Y方向）に相隣接する画素電極9a間の間隙付近となる。

【0085】そこで図3及び図5に示すように第1実施形態では、走査線3aに沿った領域に盛り上り部301を形成し、この盛り上り部301上に配置された画素電極9aの縁付近における縦電界を強めるようにする。より具体的には、図5に示すように、盛り上り部301上に配置された画素電極9aの縁付近と対向電極21との距離 d_1 を盛り上り部301の段差（高さ）の分だけ決める。これに対し図4に示すように、データ線6aに対しては、平坦化処理が施されており、画素電極9aの縁付近と対向電極21との間の距離 d_2 は、画素電極の大部分を占める中央領域における画素電極9aと対向電極21との間の距離 D とがほぼ同じになるように溝201を形成する。ここで、平坦化した部分における画素電極9aの縁付近と対向電極21との距離 d_2 は、画素電極の略中心上における液晶層50のセルギャップ D との間に $D-d_2 \leq \pm 300 \text{ nm}$ の関係が成り立つようにする。すなわち、横電界が発生しない領域において、液晶のセルギャップ D との間に300nm以上の段差が生じると光抜けが発生する可能性があるためである。

【0086】従って、図6に示した横電界の発生領域C1において、画素電極9aと対向電極21との間にお

る縦電界を強めることができるのである。そして、図5において、距離 d_1 が狭まっても、相隣接する画素電極9a間の間隙 W_1 は一定であるため、間隙 W_1 が狭まる程に強まる横電界の大きさを一定にできる。このため、図6に示した横電界の発生領域C1において局所的に、横電界よりも縦電界を強めることができ、この結果として縦電界をより支配的にすることにより、横電界の発生領域C1における液晶の配向不良を防止できるのである。

【0087】尚、図4に示すように、データ線6aに対しては、平坦化処理が施されているので、この部分においてデータ線6a等による段差に起因した液晶の配向不良の発生を低減可能である。ここでは平坦化処理が施されているため、画素電極9aと対向電極21との間の距離 d_2 が短くなることにより縦電界が強められることはないが、この部分では、図6に示したように相隣接する画素電極9a間に横電界は発生しない。従って、この部分では、横電界に対する対策を講ずることなく、平坦化処理により液晶の配向状態を極めて良好にできるのである。

【0088】以上の結果、第1実施形態によれば、1H反転駆動方式において発生する横電界の特性に着目して、横電界の発生領域C1では、盛上り部301に画素電極9aの縁を配置することで、縦電界を強めることにより横電界による悪影響を低減すると同時に、横電界の発生しない領域では、平坦化を行うことで、画素電極9a表面の段差による悪影響を低減する。このように横電界による液晶の配向不良と段差による液晶の配向不良を総合的に低減することにより、液晶の配向不良箇所を隠すための遮光膜23も小さくて済む。従って、光抜け等の画質不良を起こさずに各画素の開口率を高めることができ、最終的にコントラスト比が高く且つ明るく高品位の画像表示が可能となる。

【0089】因みに本願発明者の研究によれば、液晶層50の層厚は、耐光性のある程度のレベルに維持し、液晶50の注入プロセスを困難にせず、動作中における電界印加により液晶分子が良好に動くようにするために、ある程度の層厚（例えば、現行の技術によれば $3\mu\text{m}$ 程度）が必要である。他方、相隣接する画素電極9a間の間隙 W_1 （図5参照）を、この部分における画素電極9aと対向電極21との間の距離 d_1 より短く（即ち、 $W_1 < d_1$ ）にしてしまうと、横電界による悪影響が顕在化し始めることが判明している。従って微細ピッチな画素の高開口率化を図るために、単純に液晶層50の層厚 D （図4及び図5参照）を全体に薄くしたのでは、液晶の層厚制御の困難化、耐光性の低下、注入プロセスの困難化、液晶分子の動作不良等が発生してしまう。逆に微細ピッチな画素の高開口率化を図るために、液晶層50を薄くすること無く単純に相隣接する画素電極9a間の間隙 W_1 を狭めたのでは、縦電界と比べて横電界が大き

くなるため、当該横電界による液晶の配向不良が顕在化してしまう。このような液晶装置における特質を勘案すれば、上述した第1実施形態のように、横電界が生じる領域においてのみ液晶層50の層厚 d_1 を（例えば $1.5\mu\text{m}$ 程度にまで）狭めると共に画素電極9aの大部分を占めるその他の領域においては液晶層50の層厚 D を狭めないことにより、液晶層50の光透過領域における層厚 D を十分に（例えば $3\mu\text{m}$ 程度に）確保可能とし且つ横電界を相対的に強めないようにしつつ相隣接する画素電極9a間の間隙 W_1 を狭められる構成は、微細ピッチな画素の高開口率化及び表示画像の高精細化を図る上で非常に有効である。

【0090】第1実施形態では特に、図5において好ましくは、 $0.5D < W_1$ なる関係を満足するように画素電極9aを平面配置する。これは、液晶の層厚 D が画素電極9a間の間隙 W_1 の2倍以上に制御しないと、横電界による液晶の配向不良が顕在化するからである。更に、 $d_1 + 300\text{nm}$ （ナノメートル） $\leq D$ なる関係を満足するように盛上り部301を形成する。即ち、盛上り部301を段差が 300nm 以上となるまで盛り上げれば、横電界による悪影響が実用上表面化しない程度にまで、この領域における縦電界を横電界に対して大きくできる。また微細ピッチな画素の高開口率化及び表示画像の高精細化を図るためには、間隙 W_1 や間隙 W_2 をなるべく小さくするのが有効であるが、横電界の悪影響を顕在化させないためには、むやみにこの間隙 W_1 を小さくすることはできない。ここで、 $W_1 \approx d_1$ となるまで間隙 W_1 を小さく設定すれば、画質を落とさず微細ピッチな画素の高開口率化を図るためには最も効果的である。

【0091】更に第1実施形態では、盛上り部301における長手状に伸びる上面の幅方向の縁に、画素電極9aの縁が位置するように構成するのが好ましい。このように構成すれば、当該画素電極9a内の周辺部と対向電極21との間の距離 d_1 を盛上り部301の高さを最大限に利用して短くすることができる。同時に、盛上り部301における上面の幅を最大限に生かして横電界が生じる相隣接する画素電極9a間の間隙 W_1 を狭めることができる。これらにより、盛上り部301の形状を極めて効率的に利用して、横電界の発生領域C1において横電界に対して縦電界を強めることが可能となる。

【0092】尚、以上説明した盛上り部301は、走査線3aやTFT30を形成する導電膜や層間絶縁膜を利用して形成しているが、積層プロセス中にTFTアレイ基板10と画素電極9aとの間に盛上り部形成用の膜を局所的に追加形成したり、TFTアレイ基板10上の表面をエッチング処理等により土手状に形成したり、TFTアレイ基板10の表面と画素電極9aとの間に介在する層間絶縁膜等の表面をエッチング処理等により土手状に形成したりすることにより形成される。また盛上り部

301のその長手軸に垂直に切った断面形状としては、例えば台形、三角形、半円形、半楕円形、頂上付近が平坦とされた半円形又は半楕円形、若しくは側辺の傾斜が頂上に向かうに連れて徐々に増す2次曲線や3次曲線状の略台形、略三角形など各種の形状が考えられる。更に、図5に示した走査線3aや容量線3bの本線部に対して、部分的にのみ平坦化処理を施すことも可能である。例えば、これらの配線をTFTアレイ基板10や層間絶縁膜に形成された溝内に部分的に埋め込んで所望の領域に所望の高さの盛上り部を形成するようにしてもよい。従って実践的には、液晶の性質に応じて段差により生じる液晶の配向不良が小さくて済むような断面形状を適宜採用するのが望ましい。

【0093】ここで図7(b)に示すように、第1実施形態では好ましくは、液晶層50はTN(Twisted Nematic)液晶から構成されており、盛上り部301の側面にはテーパが付けられている。しかも、係るTN液晶のTFTアレイ基板10上におけるプレティルト角 θ の傾き方向とテーパの傾き方向とを合せるようにすると良い。

【0094】即ち、図7(a)に示すように、TN液晶の液晶分子50aは、電圧無印加状態では各液晶分子50aが基本的に基板面にほぼ平行な状態となるように、且つTFTアレイ基板10から対向基板20に向けて徐々に捻じれるように配向すると共に電圧印加状態では、矢印で夫々示したように各液晶分子50aが基板面から垂直に立ち上がるように配向する。このため、図7

(b)に示すように、盛上り部301の側面にテーパが付けられており、しかもTN液晶のプレティルト角 θ の傾き方向とテーパの傾き方向とが合わせられていれば、盛上り部301と対向基板20との間においては、液晶の層厚d1が側面に沿って徐々に小さくなくても、液晶の層厚Dが一定している場合に近い良好な液晶配向状態が得られる。即ち、横電界に起因した液晶配向不良を低減する盛上り部301の存在により生じる段差に起因した液晶配向不良を極力抑えることができる。仮に、図7(c)に示すようにTN液晶のプレティルト角 θ の傾き方向とテーパの傾き方向とが合わせられていなければ、盛上り部301と対向基板20との間においては、他の液晶分子50aとは反対方向に立ち上がる液晶分子50bが盛上り部301の付近に発生し、これにより配向状態が不連続な液晶配向不良が生じてしまうのである。したがって、このような領域は対向基板20やTFTアレイ基板10に遮光膜を形成して隠すようにすると良い。

【0095】或いは図8(b)に示すように、第1実施形態では、液晶層50'は、VA(Vertically Aligned)液晶からなり、テーパがほとんど付けられていない盛上り部301'を設けるようにしてもよい。

【0096】即ち、図8(a)に示すように、VA液晶は、電圧無印加状態では各液晶分子50a'が基本的に

基板面にほぼ垂直な状態となるように配向するため、平面的に見て盛上り部301'の側面にテーパが存在する領域では、液晶配向が乱れざるを得ないが、このように盛上り部301'の側面にテーパがほとんど付けられていなければ、係る側面で配向が乱れる液晶部分を極力小さくできる。従って、盛上り部301'の頂上付近におけるほぼ平坦な個所にある画素電極9aの部分と、盛上り部301'の下に有るほぼ平坦な個所にある画素電極9aの部分との両者で、図8(a)における液晶の層厚Dが一定している場合に近い良好な液晶配向状態が図8(b)のように得られる。

【0097】以上説明した第1実施形態では、溝201を掘って、データ線6a等を埋め込むことにより平坦化処理を行ったが、データ線6aの上方に位置する層間絶縁膜7や12の上面の段差をCMP(Chemical Mechanical Polishing)処理等により平らに削ることにより、或いは有機SOGを用いて平らに形成することにより、当該平坦化処理を行ってもよい。

【0098】この平坦化処理の後に、データ線6a方向や走査線3a方向に部分的に盛上り部を形成してもよい。方法としては、盛上り部を形成する領域を省いた層間絶縁膜に対してエッチングすることにより、容易に形成することができる。これにより、横電界が発生する領域に容易に盛上り部を設けることができる。

【0099】更に以上説明した第1実施形態では、画素スイッチング用TFT30は、好ましくは図3に示したようにLDD構造を持つが、低濃度ソース領域1b及び低濃度ドレイン領域1cに不純物の打ち込みを行わないオフセット構造を持ってよいし、走査線3aの一部からなるゲート電極をマスクとして高濃度で不純物を打ち込み、自己整合的に高濃度ソース及びドレイン領域を形成するセルフアライン型のTFTであってもよい。また第1実施形態では、画素スイッチング用TFT30のゲート電極を高濃度ソース領域1d及び高濃度ドレイン領域1e間に1個のみ配置したシングルゲート構造としたが、これらの間に2個以上のゲート電極を配置してもよい。このようにデュアルゲート或いはトリプルゲート以上でTFTを構成すれば、チャネルとソース及びドレイン領域との接合部のリーク電流を防止でき、オフ時の電流を低減することができる。

【0100】(第1実施形態の製造プロセス)次に、以上のような構成を持つ第1実施形態における電気光学装置を構成するTFTアレイ基板側の製造プロセスについて、図9を参照して説明する。尚、図9は各工程におけるTFTアレイ基板側の各層を、図4及び図5と同様に図2のB-B'断面及び図2のC-C'断面对応させて示す工程図である。

【0101】先ず図9の工程(a)に示すように、先ず石英基板、ハードガラス基板、シリコン基板等のTFTアレイ基板10を用意し、データ線6aを形成すべき領

域に溝201を形成する。

【0102】次に図9の工程(b)に示すように、薄膜形成技術を用いて、TFTアレ基板10上に、走査線3a及び容量線3bを形成する。これと平行して、図3に示した如きTFT30及び蓄積容量70を形成する。

【0103】より具体的には、溝201が形成されたTFTアレ基板10上に、例えば、常圧又は減圧CVD法等によりTEOS(テトラ・エチル・オルソ・シリケート)ガス、TEB(テトラ・エチル・ボートレート)ガス、TMOP(テトラ・メチル・オキシ・フォスレート)ガス等を用いて、NSG、PSG、BSG、BPSGなどのシリケートガラス膜、窒化シリコン膜や酸化シリコン膜等からなり、膜厚が約500~2000nmの下地絶縁膜12を形成する。次に、下地絶縁膜12の上に、減圧CVD等によりアモルファスシリコン膜を形成し熱処理を施すことにより、ポリシリコン膜を固相成長させる。或いは、アモルファスシリコン膜を経ないで、減圧CVD法等によりポリシリコン膜を直接形成する。次に、このポリシリコン膜に対し、フォトリソグラフィ工程、エッチング工程等を施すことにより、図2に示した如き第1蓄積容量電極1fを含む所定パターンを有する半導体層1aを形成する。次に、熱酸化すること等により、図3に示したTFT30のゲート絶縁膜と共に蓄積容量形成用の誘電体膜を含む絶縁薄膜2を形成する。この結果、半導体層1aの厚さは、約30~150nmの厚さ、好ましくは約35~50nmの厚さとなり、絶縁薄膜2の厚さは、約20~150nmの厚さ、好ましくは約30~100nmの厚さとなる。次に、減圧CVD法等によりポリシリコン膜を約100~500nmの厚さに堆積し、更にP(リン)を打ち込んだり、熱拡散して、このポリシリコン膜を導電化した後、フォトリソグラフィ工程、エッチング工程等により、図2に示した如き所定パターンの走査線3a及び容量線3bを形成する。尚、走査線3a及び容量線3bは、高融点金属や金属シリサイド等の金属合金膜で形成しても良いし、ポリシリコン膜等と組み合わせた多層配線としても良い。次に、低濃度及び高濃度の2段階で不純物をドーピングすることにより、低濃度ソース領域1b及び低濃度ドレイン領域1c、高濃度ソース領域1d及び高濃度ドレイン領域1eを含む、LDD構造の画素スイッチング用TFT30を形成する。

【0104】尚、図9の工程(b)と並行して、TFTから構成されるデータ線駆動回路、走査線駆動回路等の周辺回路を構成するTFTをTFTアレ基板10上の周辺部に形成してもよい。

【0105】次に図9の工程(c)に示すように、走査線3a、容量線3b、絶縁薄膜2及び下地絶縁膜12からなる積層体を覆うように、例えば、常圧又は減圧CVD法やTEOSガス等を用いて、NSG、PSG、BSG、BPSGなどのシリケートガラス膜、窒化シリコン

膜や酸化シリコン膜等からなる層間絶縁膜4を形成する。層間絶縁膜4は、例えば1000~2000nm程度の膜厚とされる。尚、この熱焼成と並行して或いは相前後して、半導体層1aを活性化するために約1000℃の熱処理を行ってもよい。そして、図3に示したデータ線6aと半導体層1aの高濃度ソース領域1dを電気接続するためのコンタクトホール5を第1層間絶縁膜4及び絶縁薄膜2に開孔し、また、走査線3aや容量線3bを基板周辺領域において図示しない配線と接続するためのコンタクトホールも、コンタクトホール5と同一の工程により開孔することができる。続いて、第1層間絶縁膜4の上に、スパッタリング工程等により、Al等の低抵抗金属膜や金属シリサイド膜を約100~500nmの厚さに堆積した後、フォトリソグラフィ工程及びエッチング工程等により、データ線6aを形成する。

【0106】次に図9の工程(d)に示すように、データ線6a上に第2層間絶縁膜7が形成される。また、図3に示したように、画素電極9aと高濃度ドレイン領域1eとを電気接続するためのコンタクトホール8を、反応性イオンエッチング、反応性イオンビームエッチング等のドライエッチング或いはウェットエッチングにより形成する。続いて、第2層間絶縁膜7の上に、スパッタリング工程等により、ITO膜等の透明導電性薄膜を、約50~200nmの厚さに堆積し、更にフォトリソグラフィ工程及びエッチング工程等により、画素電極9aを形成する。尚、当該電気光学装置を反射型として用いる場合には、Al等の反射率の高い不透明な材料から画素電極9aを形成してもよい。

【0107】以上のように第1実施形態の製造方法によれば、TFTアレ基板10に溝201を掘ってデータ線6aを形成して、データ線6aに対する平坦化処理を施すと共に、走査線3a及び容量線3bの一部に対しては平坦化処理を施さないで、横電界の発生しない領域では段差による液晶配向不良を低減し、横電界の発生する領域では盛り部301により横電界による液晶配向不良を低減する第1実施形態の液晶装置を比較的容易に製造できる。

【0108】(第2実施形態)本発明の第2実施形態における電気光学装置の構成について、図10から図14を参照して説明する。図10は、データ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレ基板の相隣接する複数の画素群の平面図であり、図11は、図10のA-A'断面図であり、図12は、図10のB-B'断面図であり、図13は、図10のC-C'断面図である。また図14は、1S反転駆動方式における各電極における電位極性と横電界が生じる領域とを示す画素電極の図式的平面図である。尚、図11から図13においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大ききとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならしめてある。また、図10から図14に示した第2実施形態において図2か

ら図6に示した第1実施形態と同様の構成要素については、同様の参照符号を付し、その説明は省略する。

【0109】第2実施形態における回路構成については、図1に示した第1実施形態の場合と同様である。

【0110】図10に示すように、第2実施形態では、第1実施形態で溝201がデータ線6aに沿った領域に掘られていたのに対し、走査線3a及び容量線3bに沿った領域（図中、太線で囲まれた領域）に溝202が掘られている。そして第2実施形態では、図11及び図12に示すように、データ線6aに沿ってデータ線6a及びこれに沿った蓄積容量70部分（即ち、容量線3bのうち平面的に見て本線部からデータ線6aに沿って突出した部分並びにこれに対向する絶縁薄膜2及び蓄積容量電極1f部分）から盛上り部302が形成されており、図12及び図13に示すように、走査線3a及び容量線3bに対して平坦化処理が施されている。更に、図14に示すように第2実施形態では、1S反転駆動方式により駆動される。第2実施形態におけるその他の構成及び動作については、第1実施形態の場合と同様である。

【0111】即ち第2実施形態では、図14(a)に示すように、 n （但し、 n は自然数）番目のフィールド或いはフレームの画像信号を表示する期間中には、画素電極9a毎に+又は-で示す液晶駆動電位の極性は反転されず、列毎に同一極性で画素電極9aが駆動される。その後図14(b)に示すように、 $n+1$ 番目のフィールド或いは1フレームの画像信号を表示するに際し、各画素電極9aにおける液晶駆動電位の極性は反転され、この $n+1$ 番目のフィールド或いは1フレームの画像信号を表示する期間中には、画素電極9a毎に+又は-で示す液晶駆動電位の極性は反転されず、列毎に同一極性で画素電極9aが駆動される。そして、図14(a)及び図14(b)に示した状態が、1フィールド又は1フレームの周期で繰り返されて、本実施形態における1S反転駆動方式による駆動が行われる。この結果、本実施形態によれば、直流電圧印加による液晶の劣化を避けつつ、クロストークやフリッカの低減された画像表示を行える。

【0112】図14(a)及び図14(b)から分かるように、1S反転駆動方式では、横電界の発生領域C2は常時、横方向(X方向)に相隣接する画素電極9a間の間隙付近となる。

【0113】そこで図11及び図12に示すように第2実施形態では、盛上り部302を形成し、この盛上り部302上に配置された画素電極9aの縁付近における縦電界を強めるようにする。より具体的には、図12に示すように、盛上り部302上に配置された画素電極9aの縁付近と対向電極21との距離 d_2 を盛上り部302の段差(高さ)の分だけ狭める。これに対し図13に示すように、走査線3a及び容量線3bの本線部に対しては、平坦化処理が施されており、画素電極9aの縁付近

と対向電極21との間の距離 d_1 は、画素電極9aの大部分を占める中央領域と対向電極21との間の距離 D とほぼ同じとなる。

【0114】従って、図14に示した横電界の発生領域C2において、画素電極9aと対向電極21との間における縦電界を強めることができるのである。そして、図12において、距離 d_2 が狭まっても、相隣接する画素電極9a間の間隙W2は一定であるため、間隙W2が狭まる程に強まる横電界の大きさを一定にできる。このため、図14に示した横電界の発生領域C2において局所的に、横電界に対する縦電界を強めることができ、この結果として縦電界をより支配的にすることにより、横電界の発生領域C2における横電界による液晶の配向不良を防止できるのである。

【0115】尚、図13に示すように、走査線3a及び容量線3bの本線部に対しては、平坦化処理が施されているので、この部分において走査線3a及び容量線3bによる段差に起因した液晶の配向不良の発生を低減可能である。ここでは平坦化処理が施されているため、画素電極9aと対向電極21との間の距離 d_1 が短くなることにより縦電界が強められることはないが、この部分では、図14に示したように相隣接する画素電極9a間に横電界は発生しない。従って、この部分では、横電界に対する対策を講ずることなく、平坦化処理により液晶の配向状態を極めて良好にできるのである。また第2実施形態では、走査線3a及び容量線3bに対向する液晶層50の部分では、段差による配向不良が殆ど生じないため、この部分を隠す遮光膜23の幅は、第1実施形態の場合よりも細くてよい。

【0116】以上の結果、第2実施形態によれば、1S反転駆動方式において発生する横電界の特性に着目して、横電界の発生領域C2では、盛上り部302に画素電極9aの縁を配置することで、縦電界を強めることにより横電界による悪影響を低減すると同時に、横電界の発生しない領域では、平坦化を行うことで、画素電極9a表面の段差による悪影響を低減できる。

【0117】(第3実施形態)本発明の第3実施形態における電気光学装置の構成について、図15から図22を参照して説明する。図15は、データ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図であり、図16は、図15のA-A'断面図であり、図17は、図15のB-B'断面図であり、図18は、図15のC-C'断面図である。図19及び図20は、盛上り部の各種の断面形状を示す断面図である。また、図21は、TN液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図であり、図22は、VA液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図である。尚、図16から図18並びに図19及び図20においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に

縮尺を異ならしめてある。第1実施形態と同様の構成要素については、同様の参照符号を付し、その説明は省略する。

【0118】第3実施形態では特に、TFTアレイ基板上において、データ線6a、走査線3a、容量線3b及びTFT30が形成された画素電極9aの間隙部分には、溝が形成されており、この溝にデータ線6a、走査線3a、容量線3b及びTFT30が埋め込まれている。即ちTFTアレイ基板側における平坦化が行われている。そして、このように平坦化処理が施されたTFTアレイ基板に対向する対向基板側には、走査線3a及び容量線3bに沿った領域（図中太線でその輪郭が示された領域）に複数の盛上り部303が設けられ、ストライプ状の盛上り部を形成している。

【0119】次に図16の断面図に示すように、電気光学装置は、透明なTFTアレイ基板10と、これに対向配置される透明な対向基板20とを備えている。TFTアレイ基板10は、例えば石英基板、ガラス基板、シリコン基板からなり、対向基板20は、例えばガラス基板や石英基板からなる。TFTアレイ基板10には、画素電極9aが設けられており、その上側には、ラビング処理等の所定の配向処理が施された配向膜16が設けられている。画素電極9aは例えば、ITO (Indium Tin Oxide) 膜などの透明導電性薄膜からなる。また配向膜16は例えば、ポリイミド薄膜などの有機薄膜からなる。

【0120】他方、対向基板20には、その全面に渡って対向電極21が設けられており、その下側には、ラビング処理等の所定の配向処理が施された配向膜22が設けられている。対向電極21は例えば、ITO膜などの透明導電性薄膜からなる。また配向膜22は、ポリイミド薄膜などの有機薄膜からなる。

【0121】TFTアレイ基板10には、各画素電極9aに隣接する位置に、各画素電極9aをスイッチング制御する画素スイッチング用TFT30が設けられている。

【0122】第3実施形態では特に、対向基板20には図16に示すように、対向基板20と対向電極21との間において、各画素の非開口領域に、遮光膜23からなる盛上り部303が設けられている。ここで盛上り部303による横電界を低減する作用及び効果について後で詳述するが、この盛上り部303は遮光膜23から構成されているため、所謂ブラックマスク或いはブラックマトリクスとしても機能し、対向基板20の側から入射光が画素スイッチング用TFT30の半導体層1aのチャネル領域1a'や低濃度ソース領域1b及び低濃度ドレイン領域1cに侵入することはない。更に、遮光膜23からなる盛上り部303は、コントラスト比の向上、カラーフィルタを形成した場合における色材の混色防止などの機能を有する。尚、第3実施例では、A1等からなる遮光性のデータ線6aで、各画素の非開口領域のうち

データ線6aに沿った部分を遮光することにより、各画素の開口領域のうちデータ線6aに沿った輪郭部分を規定してもよいし、このデータ線6aに沿った非開口領域についても冗長的に又は単独に対向基板20に設けられた遮光膜23からなる盛上り部303で遮光するように構成してもよい。

【0123】このように構成され、画素電極9aと対向電極21とが対面するように配置されたTFTアレイ基板10と対向基板20との間には、後述のシール材により囲まれた空間に電気光学物質の一例である液晶が封入され、液晶層50が形成される。液晶層50は、画素電極9aからの電界が印加されていない状態で配向膜16及び22により所定の配向状態をとる。液晶層50は、例えば一種又は数種類のネマティック液晶を混合した液晶からなる。シール材は、TFTアレイ基板10及び対向基板20をそれらの周辺で貼り合わせるための、例えば光硬化性樹脂や熱硬化性樹脂からなる接着剤であり、両基板間の距離を所定値とするためのガラスファイバー或いはガラスビーズ等のギャップ材が混入されている。

【0124】更に、TFTアレイ基板10と複数の画素スイッチング用TFT30との間には、下地絶縁膜12が設けられている。下地絶縁膜12は、TFTアレイ基板10の全面に形成されることにより、TFTアレイ基板10の表面の研磨時における荒れや、洗浄後に残る汚れ等で画素スイッチング用TFT30の特性の変化を防止する機能を有する。下地絶縁膜12は、例えば、NSG（ノンドープトシリケートガラス）、PSG（リンシリケートガラス）、BSG（ボロンシリケートガラス）、BPSG（ボロンリンシリケートガラス）などの高絶縁性ガラス又は、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜等からなる。

【0125】第3実施形態では、半導体層1aを高濃度ドレイン領域1eから延設して第1蓄積容量電極1fとし、これに対向する容量線3bの一部を第2蓄積容量電極とし、ゲート絶縁膜を含んだ絶縁薄膜2を走査線3aに対向する位置から延設してこれらの電極間に挟持された誘電体膜とすることにより、蓄積容量70が構成されている。

【0126】図16において、画素スイッチング用TFT30は、LDD構造を有しており、走査線3a、当該走査線3aからの電界によりチャネルが形成される半導体層1aのチャネル領域1a'、走査線3aと半導体層1aとを絶縁するゲート絶縁膜を含む絶縁薄膜2、データ線6a、半導体層1aの低濃度ソース領域1b及び低濃度ドレイン領域1c、半導体層1aの高濃度ソース領域1d並びに高濃度ドレイン領域1eを備えている。高濃度ドレイン領域1eには、複数の画素電極9aのうちの対応する一つがコンタクトホール8を介して接続されている。また、走査線3a及び容量線3bの上には、高濃度ソース領域1dへ通じるコンタクトホール5及び高

濃度ドレイン領域1eへ通じるコンタクトホール8が各々形成された第1層間絶縁膜4が形成されている。更に、データ線6a及び第1層間絶縁膜4の上には、高濃度ドレイン領域1eへのコンタクトホール8が形成された第2層間絶縁膜7が形成されている。前述の画素電極9aは、このように構成された第2層間絶縁膜7の上面に設けられている。

【0127】図16から図18に示すように、TFTアレイ基板10上において、各データ線6a、各走査線3a、各容量線3b及び各TFT30が形成される領域には、溝201が設けられており、これにより、TFTアレイ基板10上における平坦化処理が施されている。

【0128】図15乃至図17に示すように、左右に相隣接する画素電極9aの間隙に位置する各画素の非開口領域には、データ線6aが設けられている。データ線6aにより各画素の開口領域の輪郭のうちデータ線6aに沿った部分が規定されており、且つデータ線6aにより当該非開口領域における光抜けが防止されている。また、データ線6aの下には、容量線3bの本線部からデータ線6aの下に沿って突出した部分を利用して、蓄積容量70が形成されており、非開口領域の有効利用が図られている。

【0129】図16及び図18に示すように、図15で上下に相隣接する画素電極9aの間隙に位置する各画素の非開口領域には、走査線3a及び容量線3bの本線部が設けられている。

【0130】第3実施形態では特に、図15に示すように、左右に相隣接する画素電極9aの間隙に対向する対向基板20における対向電極21の下地面には、盛上り部は設けられておらず、図17に示すように対向電極21は平坦に形成されている。これに対し、図15に示すように、上下に相隣接する画素電極9aの間隙に対向する対向基板20における対向電極21の下地面は、図18に示すように土手状に盛り上がっている。即ち、遮光膜23からなる盛上り部303が形成されており、対向電極21は、画素電極9a側に向かって突出して形成されている。尚、盛上り部303により各画素の開口領域の輪郭のうち走査線3aに沿った部分が規定されており、且つ遮光膜23からなる盛上り部301により当該非開口領域における光抜けが防止されている。

【0131】図16及び図18に示すように第3実施形態では、走査線3aに沿った領域に盛上り部303を形成し、この盛上り部303上に配置された対向電極21の突出部付近における縦電界を強めるようにする。より具体的には、図18に示すように、盛上り部303上に配置された対向電極21と画素電極9aとの距離d1を盛上り部303の段差(高さ)の分だけ狭める。これに対し図17に示すように、データ線6aに対向する領域には盛上り部303が形成されておらず、画素電極9aの縁付近と対向電極21との間の距離d2は、画素電極

の大部分を占める中央領域における画素電極9aと対向電極21との間の距離Dとがほぼ同じとなる。

【0132】従って、図6に示した横電界の発生領域C1において、画素電極9aと対向電極21との間における縦電界を強めることができるのである。そして、図18において、距離d1が狭まっても、相隣接する画素電極9a間の間隙W1は一定であるため、間隙W1が狭まる程に強まる横電界の大きさを一定にできる。このため、図6に示した横電界の発生領域C1において局所的に、横電界に対する縦電界を強めることができ、この結果として縦電界をより支配的にすることにより、横電界の発生領域C1における横電界による液晶の配向不良を防止できるのである。

【0133】尚、図17に示すように、データ線6aに対向する領域には盛上り部303が形成されておらず対向電極21は平坦であるので、この部分において盛上り部303の存在による段差に起因した液晶の配向不良の発生を低減可能である。ここでは平坦なため、画素電極9aと対向電極21との間の距離d2が短くなることにより縦電界が強められることはないが、この部分では、図6に示したように相隣接する画素電極9a間に横電界は発生しない。従って、この部分では、横電界に対する対策を講ずることなく、平坦化処理により液晶の配向状態を極めて良好にできるのである。

【0134】以上の結果、第3実施形態によれば、1H反転駆動方式において発生する横電界の特性に着目して、横電界の発生領域C1では、盛上り部303で対向電極21を突出させることで、縦電界を強めることにより横電界による悪影響を低減すると同時に、横電界の発生しない領域では、対向電極21を平坦にすることで、対向電極21表面の段差による悪影響を低減する。このように横電界による液晶の配向不良と段差による液晶の配向不良を総合的に低減することにより、液晶の配向不良箇所を隠すための遮光膜23からなる盛上り部303の幅も小さくて済む(但し、盛上り部303における段差に起因した液晶の配向不良箇所を覆い隠すためには、盛上り部303の幅よりも若干広めの幅を持つ遮光膜23を一体的に又は別体から形成するのが望ましい)。従って、光抜け等の画質不良を起こさずに各画素の開口率を高めることができ、最終的にコントラスト比が高く且つ明るく高品位の画像表示が可能となる。

【0135】因みに本願発明者の研究によれば、液晶層50の層厚Dは、耐光性のある程度のレベルに維持し、液晶50の注入プロセスを困難にせず、動作中における電界印加により液晶分子が良好に動くようにするために、ある程度の層厚(例えば、現行の技術によれば3 μ m程度)が必要である。他方、相隣接する画素電極9a間の間隙W1(図18参照)を、この部分における画素電極9aと対向電極21との間の距離d1より短く(即ち、 $W1 < d1$)にしてしまうと、横電界による悪影響

が顕在化し始めることが判明している。従って微細ピッチな画素の高開口率化を図るために、単純に液晶層50の層厚D(図17及び図18参照)を全体に薄くしたのでは、液晶層厚制御の均一化が困難になり、耐光性が低下し、注入プロセスが困難になり、液晶分子の動作不良等が発生してしまう。逆に微細ピッチな画素の高開口率化を図るために、液晶層50を薄くすること無く単純に相隣接する画素電極9a間の間隙W1を狭めたのでは、縦電界と比べて横電界が大きくなるため、当該横電界による悪影響(即ち液晶の配向不良)が顕在化してしまう。このような液晶装置における特質を勘案すれば、上述した本実施形態のように、横電界が生じる領域においてのみ液晶層50の層厚d1を(例えば1.5 μ m程度にまで)狭めると共に、画素電極9aの大部分を占めるその他の領域においては液晶層50の層厚Dを狭めないことにより横電界を相対的に強めないようにする。これにより相隣接する画素電極9a間の間隙W1を狭められるため、微細ピッチな画素の高開口率化及び表示画像の高精細化を図る上で非常に有効である。

【0136】第3実施形態では特に、図18において好ましくは、 $0.5D < W1$ なる関係を満足するように画素電極9aを平面配置し、更に、 $d1 + 300\text{nm}$ (ナノメータ) $\leq D$ なる関係を満足するように盛上り部303を形成する。即ち、画素電極9a間を余り近づけないようにし且つ盛上り部303を段差が300nm以上となるまで盛り上げれば、横電界による悪影響が実用上表面化しない程度にまで、この領域における縦電界を横電界に対して大きくできる。また微細ピッチな画素の高開口率化及び表示画像の高精細化を図るためには、間隙W1や間隙W2をなるべく小さくするのが有効であるが、横電界の悪影響を顕在化させないためには、むやみにこの間隙W1を小さくすることはできない。ここで、 $W1 \approx d1$ となるまで間隙W1を小さく設定すれば、画質を落とさず微細ピッチな画素の高開口率化を図るためには最も効果的である。

【0137】尚、以上説明した盛上り部303は、遮光膜23を利用して形成しているが、積層プロセス中に対向基板20と対向電極21との間に有機膜やレジストなどの土手形成用の膜を局部的に追加形成することにより形成してもよい。また盛上り部303のその長手軸に垂直に切った断面形状としては、例えば台形、三角形、半円形、半楕円形、頂上付近が平坦とされた半円形又は半楕円形、若しくは側辺の傾斜が頂上に向かうに連れて徐々に増す2次曲線や3次曲線状の略台形、略三角形など各種の形状が考えられる。従って実践的には、液晶の性質に応じて段差により生じる液晶の配向不良が小さくて済むような断面形状を適宜採用するのが望ましい。更に、盛上り部303を形成することにより、段差による液晶配向不良が発生するため、盛上り部303よりも若干幅広い遮光膜23を盛上り部303と対向基板20と

の間に配置したり、盛上り部303と画素電極との間に配置することが望ましい。

【0138】例えば、長手方向に垂直な平面で切った断面形状が三角形である盛上り部303を、図19(a)に示すように、遮光膜23から形成してもよいし、図19(b)に示すように、盛上り部303より若干幅広い遮光膜23上にレジストや有機膜からなる盛上り部形成用膜313から形成してもよいし、図19(c)に示すように、対向基板20上にレジストや有機膜からなる盛上り部形成用膜313を形成してその上に遮光膜23で若干広めに覆うようにしてもよいし、図19(d)に示すように、対向基板20上にレジストや有機膜からなる盛上り部形成用膜313を形成してその上に遮光膜を形成しないようにしてもよい(但し、この場合には、TFTアレイ基板側に、この部分を覆う遮光膜を形成する)。

【0139】更に、盛上り部303における長手方向に垂直な平面で切った断面形状を、図20(a)に示すように矩形としてもよいし、図20(b)に示すように半円形としてもよいし、図20(c)に示すように台形としてもよいし、図20(d)に示すように略台形としてもよい。図20に示したこれらの積層構造は、図19(a)と同様に対向基板20上に設けた遮光膜23から盛上り部303を形成するようにしたが、これらは図19(a)～図19(d)に示したいずれの積層構造であってもよい。更に、対向基板20上には、カラーフィルタ、保護膜、絶縁膜等が形成されてもよい。実際の積層構造としては、更に各種のバリニーションが考えられる。

【0140】ここで図21(b)に示すように、第3実施形態では好ましくは、液晶層50はTN液晶から構成されており、盛上り部303の側面にはテーパが付けられている。しかも、係るTN液晶の対向基板20上におけるプレティルト角 θ の傾き方向とテーパの傾き方向とが合わせられている。

【0141】即ち、図21(a)に示すように、TN液晶の液晶分子50aは、電圧無印加状態では各液晶分子50aが基本的に基板面にほぼ平行な状態でTFTアレイ基板10から対向基板20に向けて徐々に捻じれるように配向すると共に電圧印加状態では、矢印で夫々示したように各液晶分子50aが基板面から垂直に立ち上がるように配向する。このため、図21(b)に示すように、盛上り部303の側面にテーパが付けられており、しかもTN液晶のプレティルト角 θ の傾き方向とテーパの傾き方向とが合わせられていれば、盛上り部303とTFTアレイ基板10との間においては、液晶の層厚d1が側面に沿って徐々に小さくなくても、液晶の層厚Dが一定している場合に近い良好な液晶配向状態が得られる。即ち、横電界に起因した液晶配向不良を低減する盛上り部303の存在により生じる段差に起因した液晶配

向不良を極力抑えることができる。仮に、図21(c)に示すようにTN液晶のプレティルト角 θ の傾き方向とテーバの傾き方向とが合わせられていなければ、盛上り部303とTFTアレイ基板10との間においては、他の液晶分子50aとは反対方向に立ち上がる液晶分子50bが盛上り部303の付近に発生し、これにより配向状態が不連続な液晶配向不良が生じてしまうのである。このような場合は対向基板20あるいはTFTアレイ基板10の少なくとも一方に遮光膜を形成して光抜けを抑制するようにすると良い。

【0142】或いは図22(b)に示すように、第3実施形態では、液晶層50'は、VA液晶からなり、テーバがほとんど付けられていない盛上り部303'を設けるようにしてもよい。

【0143】即ち、図22(a)に示すように、VA液晶は、電圧無印加状態では各液晶分子50a'が基本的に基板面にほぼ垂直な状態となるように配向するため、平面的に見て盛上り部303'の側面にテーバが存在する領域では、液晶配向が乱れざるを得ないが、このように盛上り部303'の側面にテーバがほとんど付けられていなければ、係る側面で配向が乱れる液晶部分を極力小さくできる。従って、盛上り部303'の頂上付近におけるほぼ平坦な個所にある画素電極9aの部分と、盛上り部303'の下に有るほぼ平坦な個所にある画素電極9aの部分との両者で、図22(a)における液晶の層厚Dが一定している場合に近い良好な液晶配向状態が図22(b)のように得られる。

【0144】以上説明した第1実施形態から第3実施形態では、TFTアレイ基板10上に溝201を掘って、走査線3a等を埋め込むことにより平坦化処理を行ったが、走査線3aの上方に位置する層間絶縁膜7や12の上面の段差をCMP (Chemical Mechanical Polishing) 処理等により平らに削ることにより、或いは有機SOGを用いて平らに形成することにより、当該平坦化処理を行ってもよい。

【0145】この平坦化処理の後に、データ線6a方向や走査線3a方向に部分的に盛上り部を形成してもよい。方法としては、盛上り部を形成する領域を省いた層間絶縁膜に対してエッチングすることにより、容易に形成することができる。これにより、横電界が発生する領域に容易に盛上り部を設けることができる。このように、横電界が発生する領域に対して、TFTアレイ基板10と対向基板20の両方の基板に盛上り部を形成してもよいということは言うまでもない。

【0146】(第3実施形態の製造プロセス) 次に、以上のような構成を持つ第3実施形態における電気光学装置を構成する対向基板側の製造プロセスについて、図23を参照して説明する。尚、図23は各工程における対向基板側の各層を、図18と同様に図15のC-C'断面对称させて示す工程図である。

【0147】先ず図23の工程(a)に示すように、先ず対向基板20として、所定形状のガラス基板、石英基板を用意する。

【0148】次に図23の工程(b)に示すように、有機膜、金属膜等の遮光膜23'を300nm程度の膜厚に形成する。

【0149】次に図23の工程(c)に示すように、フォトリソグラフィ処理及びエッチング処理を用いたパターンニングにより、TFTアレイ基板上で横電界が発生する領域に、帯状の遮光膜23を盛上り部形成用の膜として形成することにより、盛上り部303を形成する。

【0150】次に図23の工程(d)に示すように、盛上り部303上に、ITO (Indium Tin Oxide) 膜などの透明導電性薄膜から対向電極を形成し、更に、その上に、ポリイミド薄膜などの有機薄膜から配向膜22を形成し、所定のラビング方向にラビングする。

【0151】尚、工程(b)及び工程(c)に代えて、印刷技術により、遮光膜からなる盛上り部303を形成してもよい。

【0152】以上のように第3実施形態の製造方法によれば、横電界の発生する領域では盛上り部303により横電界による液晶配向不良を低減する液晶装置を比較的容易に製造できる。

【0153】次に、上述した第3実施形態における対向基板20上に形成される盛上り部303と遮光膜との平面レイアウトの具体例について、図24及び図25を参照して説明する。尚、これらの具体例は夫々、TFTアレイ基板10側で、データ線6aに沿うY方向に伸びる画素電極間9aの間隙をデータ線6a等により遮光し、対向基板20側の遮光膜により走査線3aに沿うX方向に伸びる画素電極9aの間隙を覆うものである。

【0154】図24(a)に示すように、盛上り部303a及び遮光膜23aは共に、複数の画素電極9aに跨ってX方向にストライプ状に伸びるように形成されてもよい。図24(b)に示すように、盛上り部303aは、複数の画素電極9aに跨ってX方向にストライプ状に伸びるように形成されると共に遮光膜23bは、画素電極9a毎に島状に形成されてもよい。図25(a)に示すように、盛上り部303bは、画素電極9a毎に島状に形成されると共に遮光膜23aは、複数の画素電極9aに跨ってX方向にストライプ状に伸び形成されてもよい。或いは、図25(b)に示すように、盛上り部303b及び遮光膜23bは共に、画素電極9a毎に島状に形成されてもよい。図24及び図25に示した何れの場合にも、盛上り部303a又は303bにより、横電界が発生する領域における縦電界を強めることができる。同時に盛上り部303a又は303bの存在による液晶配向不良を、遮光膜23a又は23bにより隠すことができる。

【0155】このように、横電界が発生する領域におい

て、対向基板上の遮光膜及び盛上り部の配置を工夫することで、画素ピッチが微細化しても高開口率な液晶装置を実現できる。

【0156】（第4実施形態）本発明の第4実施形態における電気光学装置の構成について、図26から図29を参照して説明する。図26は、データ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図であり、図27は、図26のA-A'断面図であり、図28は、図26のB-B'断面図であり、図29は、図26のC-C'断面図である。

尚、図27から図29においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならしめてある。また、図26から図29に示した第4実施形態において図15から図18に示した第3実施形態と同様の構成要素については、同様の参照符号を付し、その説明は省略する。

【0157】図14から図16に示すように、第4実施形態では、第3実施形態で盛上り部303が走査線3aに沿って形成されていたのに対し、対向基板20上におけるデータ線6aに沿った領域（図14中、太線で囲まれた領域）に盛上り部304が形成されている。この場合、データ線6aが遮光膜として機能するので、盛上り部304は、遮光膜から形成されてもよいし、透明な材料膜から形成されてもよい。図27及び図29に示すように、走査線3a及び容量線3bの本線部に対向する個所では、対向基板20は平坦に形成されている。また、対向基板20上における、走査線3a及び容量線3bの本線部に対向する個所には、これらに沿って遮光膜23が形成されており、この遮光膜23により各画素の開口領域のうち少なくとも走査線3aに沿った部分が規定されている。尚、このような遮光膜23を対向基板20上におけるデータ線6aに沿った領域に形成してもよい。そして、図14に示すように第4実施形態では、1S反転駆動方式により駆動される。第4実施形態におけるその他の構成及び動作については、第3実施形態の場合と同様である。

【0158】即ち第4実施形態では、図14（a）に示すように、 n （但し、 n は自然数）番目のフィールド或いはフレームの画像信号を表示する期間中には、画素電極9a毎に+又は-で示す液晶駆動電位の極性は反転されず、列毎に同一極性で画素電極9aが駆動される。その後図14（b）に示すように、 $n+1$ 番目のフィールド或いは1フレームの画像信号を表示するに際し、各画素電極9aにおける液晶駆動電位の極性は反転され、この $n+1$ 番目のフィールド或いは1フレームの画像信号を表示する期間中には、画素電極9a毎に+又は-で示す液晶駆動電位の極性は反転されず、列毎に同一極性で画素電極9aが駆動される。そして、図14（a）及び図14（b）に示した状態が、1フィールド又は1フレームの周期で繰り返されて、第4実施形態における1S

反転駆動方式による駆動が行われる。この結果、第4実施形態によれば、直流電圧印加による液晶の劣化を避けつつ、クロストークやフリッカの低減された画像表示を行える。

【0159】図14（a）及び図14（b）から分かるように、1S反転駆動方式では、横電界の発生領域C2は常時、横方向（X方向）に相隣接する画素電極9a間の間隙付近となる。

【0160】そこで図27及び図28に示すように第4実施形態では、盛上り部304を形成し、この盛上り部304上に配置された対向電極21を突出させて縦電界を強めるようにする。より具体的には、図28に示すように、盛上り部304上に配置された対向電極21と画素電極9aとの距離 d_2 を盛上り部304の段差（高さ）の分だけ狭める。これに対し図29に示すように、走査線3a及び容量線3bに対向する個所では対向基板20は平坦なので、対向電極21と画素電極9aとの間の距離 d_1 は、画素電極の大部分を占める中央領域における画素電極9aと対向電極21との間の距離 D とほぼ同じとなる。

【0161】従って、図14に示した横電界の発生領域C2において、画素電極9aと対向電極21との間における縦電界を強めることができるのである。そして、図28において、距離 d_2 が狭まっても、相隣接する画素電極9a間の間隙 W_2 は一定であるため、間隙 W_2 が狭まる程に強まる横電界の大きさも一定である。このため、図14に示した横電界の発生領域C2において局所的に、横電界に対する縦電界を強めることができ、この結果として縦電界をより支配的にすることにより、横電界の発生領域C2における横電界による液晶の配向不良を防止できるのである。

【0162】尚、図29に示すように、走査線3a及び容量線3bの本線部に対向する個所では、対向基板21は平坦なので、この部分において盛上り部304の存在による段差に起因した液晶の配向不良の発生を低減可能である。ここでは平坦なため、画素電極9aと対向電極21との間の距離 d_1 が短くなることにより縦電界が強められることはないが、この部分では、図14に示したように相隣接する画素電極9a間に横電界は発生しない。従って、この部分では、横電界に対する対策を講ずることなく、平坦化処理により液晶の配向状態を極めて良好にできるのである。また第4実施形態では、このように走査線3a及び容量線3bの本線部に対向する液晶層50の部分では、段差による配向不良が殆ど生じないため、この部分を隠す遮光膜の幅は、第3実施形態の場合よりも細くてよい。

【0163】以上の結果、第4実施形態によれば、1S反転駆動方式において発生する横電界の特性に着目して、横電界の発生領域C2では、盛上り部304に画素電極9aの端に配置することで、縦電界を強めることに

より横電界による悪影響を低減すると同時に、横電界の発生しない領域では、平坦化を行うことで、画素電極9a表面の段差による悪影響を低減できる。

【0164】更に上述した第3実施形態及び第4実施形態において、上述の如く対向基板20側に盛上り部303や304を形成するのに加えて、TFTアレイ基板10上における画素電極9aの下地面が、走査線3a及び容量線3bの本線部に対向する領域で、或いはデータ線6aに対向する領域で、土手状に盛り上がっているように構成してもよい。この様に構成しても横電界が発生する領域において各画素電極9aと対向電極21との間の距離が短くなるので、上述と同様の効果が得られる。更にまた、データ線6a、走査線3a、容量線3b及びTFT30に対して、部分的にのみ平坦化処理を施すことも可能である。例えば、これらの配線やTFTをTFTアレイ基板10や層間絶縁膜に形成された溝内に部分的に埋め込んで所望の領域に所望の高さの盛上り部を形成するようにしてもよい。

【0165】（第5実施形態）本発明の第5実施形態における電気光学装置の構成について、図30を参照して説明する。図30は、走査線及び容量線が延びる部位の断面図である。第1実施形態と同様の構成要素については、同様の参照符号を付し、その説明は省略する。

【0166】図30に示すように、第5実施形態では、第1実施形態で走査線3aと容量線3bは同層に隣接して形成されたのに対し、容量線3bは、走査線3aの領域上に第1層間絶縁膜4を介して配置されている。容量線3bには絶縁薄膜61を介して第1蓄積容量電極62が配置され蓄積容量70が形成される。容量線3bは高融点金属の遮光性材料でなり、走査線3bを遮光する。

【0167】そして、容量線3b上に盛上り部305が形成し、この盛上り部305上に配置された画素電極9aの縁付近における縦電界を強めるようにしている。

【0168】なお、容量線3bは、走査線3aの領域下に層間絶縁膜を介して配置してもよい。

【0169】（第6実施形態）本発明の第6実施形態における電気光学装置の構成について、図31を参照して説明する。図31は、走査線及び容量線が延びる部位の断面図である。第1実施形態と同様の構成要素については、同様の参照符号を付し、その説明は省略する。

【0170】図31に示すように、第6実施形態では、液晶の層厚Dを薄くするために、TFTアレイ基板10に形成した盛上り部306と、対向基板20に設けた盛上り部307で形成される。盛上り部306、307の構成は、第1実施形態の盛上り部301と第3実施形態の盛上り部303と同様である。そして、対向する盛上り部306、307で、盛上り部306上に配置された画素電極9aの縁付近における縦電界を強めるようにしている。

【0171】なお、第6実施形態では、各盛上り部30

6、307は対向するように配置したが、それぞれ異なる領域で形成してもよい。

【0172】尚、以上述べた本発明における1H反転駆動方式では駆動電位の極性を、一行毎に反転させてもよいし、相隣接する2行毎に或いは複数行毎に反転させてもよい。同様に本発明における1S反転駆動方式では駆動電位の極性を、一列毎に反転させてもよいし、相隣接する2列毎に或いは複数列毎に反転させてもよい。

【0173】（電気光学装置の全体構成）以上のように構成された各実施形態における電気光学装置の全体構成を図32及び図33を参照して説明する。尚、図32は、TFTアレイ基板10をその上に形成された各構成要素と共に対向基板20の側から見た平面図であり、図33は、図32のH-H'断面図である。

【0174】図32において、TFTアレイ基板10の上には、シール材52がその縁に沿って設けられており、その内側に並行して、例えば遮光膜23と同じ或いは異なる材料から成る画像表示領域の周辺を規定する領域53が設けられている。シール材52の外側の領域には、データ線6aに画像信号を所定タイミングで供給することによりデータ線6aを駆動するデータ線駆動回路101及び外部回路接続端子102がTFTアレイ基板10の一辺に沿って設けられており、走査線3aに走査信号を所定タイミングで供給することにより走査線3aを駆動する走査線駆動回路104が、この一辺に隣接する2辺に沿って設けられている。走査線3aに供給される走査信号遅延が問題にならないのなら、走査線駆動回路104は片側だけでも良いことは言うまでもない。また、データ線駆動回路101を画像表示領域の辺に沿って両側に配列してもよい。例えば奇数列のデータ線は画像表示領域の一方の辺に沿って配設されたデータ線駆動回路から画像信号を供給し、偶数列のデータ線は前記画像表示領域の反対側の辺に沿って配設されたデータ線駆動回路から画像信号を供給するようにしてもよい。この様にデータ線6aを櫛歯状に駆動するようにすれば、データ線駆動回路101の占有面積を拡張することができるため、複雑な回路を構成することが可能となる。更にTFTアレイ基板10の残る一辺には、画像表示領域の両側に設けられた走査線駆動回路104間をつなぐための複数の配線105が設けられている。また、対向基板20のコーナー部の少なくとも1箇所においては、TFTアレイ基板10と対向基板20との間で電氣的に導通をとるための導通材106が設けられている。そして、図33に示すように、図32に示したシール材52とはほぼ同じ輪郭を持つ対向基板20が当該シール材52によりTFTアレイ基板10に固着されている。

【0175】尚、TFTアレイ基板10上には、これらのデータ線駆動回路101、走査線駆動回路104等に加えて、複数のデータ線6aに画像信号を所定のタイミングで印加するサンプリング回路、複数のデータ線6a

に所定電圧レベルのプリチャージ信号を画像信号に先行して各々供給するプリチャージ回路、製造途中や出荷時の当該電気光学装置の品質、欠陥等を検査するための検査回路等を形成してもよい。

【0176】以上説明した各実施形態では、データ線駆動回路101及び走査線駆動回路104をTFTアレイ基板10の上に設ける代わりに、例えばTAB Tape Automated bonding) 基板上に実装された駆動用LSIに、TFTアレイ基板10の周辺部に設けられた異方性導電フィルムを介して電氣的及び機械的に接続するようにしてもよい。また、対向基板20の投射光が入射する側及びTFTアレイ基板10の出射光が出射する側には各々、例えば、TNモード、VAモード、PDLCPolymer Dispersed Liquid Crystal) モード等の動作モードや、ノーマリーホワイトモード/ノーマリーブラックモードの別に依りて、偏光フィルム、位相差フィルム、偏光板などが所定の方向で配置される。

【0177】以上説明した各実施形態における電気光学装置は、プロジェクタに適用されるため、3枚の電気光学装置がRGB用のライトバルブとして各々用いられ、各ライトバルブには各々RGB色分解用のダイクロイックミラーを介して分解された各色の光が投射光として各々入射されることになる。従って、各実施形態では、対向基板20に、カラーフィルタは設けられていない。しかしながら、遮光膜23の形成されていない画素電極9aに対向する所定領域にRGBのカラーフィルタをその保護膜と共に、対向基板20上に形成してもよい。このようにすれば、プロジェクタ以外の直視型や反射型のカラー電気光学装置に各実施形態における電気光学装置を適用できる。

【0178】更に、以上の各実施形態において、TFTアレイ基板10上において画素スイッチング用TFT30に対向する位置(即ち、画素スイッチング用TFT30の下側)にも、例えば高融点金属からなる遮光膜を設けてもよい。このように画素スイッチング用TFT30の下側にも遮光膜を設ければ、TFTアレイ基板10の側からの裏面反射(戻り光)や複数のライトバルブをプリズム等を介して組み合わせる一つの光学系を構成する場合に、他の電気光学装置からプリズム等を突き抜けて来る投射光が当該電気光学装置の画素スイッチング用TFT30に入射するのを未然に防ぐことができる。また、対向基板20上に1画素個対応するようにマイクロレンズを形成してもよい。あるいは、TFTアレイ基板10上のRGBに対向する画素電極9a下にカラーレジスト等でカラーフィルタ層を形成することも可能である。このようにすれば、入射光の集光効率を向上することで、明るい電気光学装置が実現できる。更にまた、対向基板20上に、何層もの屈折率の相違する干渉層を堆積することで、光の干渉を利用して、RGB色を作り出すダイクロイックフィルタを形成してもよい。このダイ

クロイックフィルタ付き対向基板によれば、より明るいカラー電気光学装置が実現できる。

【0179】(電子機器の構成) 上述の実施形態の電気光学装置を用いて構成される電子機器は、図34に示す表示情報出力源1000、表示情報処理回路1002、表示駆動回路1004、液晶装置などの電気光学装置100、クロック発生回路1008及び電源回路1010を含んで構成される。表示情報出力源1000は、ROM、RAMなどのメモリ、テレビ信号を同調して出力する同調回路などを含んで構成され、クロック発生回路1008からのクロックに基づいて、ビデオ信号などの表示情報を出力する。表示情報処理回路1002は、クロック発生回路1008からのクロックに基づいて表示情報を処理して出力する。この表示情報処理回路1002は、例えば増幅・極性反転回路、シリアルパラレル変換回路、ローテーション回路、ガンマ補正回路あるいはクランプ回路等を含むことができる。表示駆動回路1004は、走査線駆動回路及びデータ線駆動回路を含んで構成され、液晶装置100を表示駆動する。電源回路1010は、上述の各回路に電力を供給する。

【0180】このような構成の電子機器として、図35に示す投射型表示装置、図36に示すマルチメディア対応のパーソナルコンピュータ(PC)及びエンジニアリング・ワークステーション(EWS)などを挙げることができる。

【0181】図35は、投射型表示装置の要部を示す概略構成図である。図中、1102は光源、1108はダイクロイックミラー、1106は反射ミラー、1122は入射レンズ、1123はリレーレンズ、1124は出射レンズ、100R、100G、100Bはライトバルブ、1112はダイクロイックプリズム、1114は投射レンズを示す。光源1102はメタルハライド等のランプとランプの光を反射するリフレクタとからなる。青色光・緑色光反射のダイクロイックミラー1108は、光源1102からの光束のうちの赤色光を透過させるとともに、青色光と緑色光とを反射する。透過した赤色光は反射ミラー1106で反射されて、赤色光用ライトバルブ100Rに入射される。一方、ダイクロイックミラー1108で反射された色光のうち緑色光は緑色光反射のダイクロイックミラー1108によって反射され、緑色光用ライトバルブ100Gに入射される。一方、青色光は第2のダイクロイックミラー1108も透過する。青色光に対しては、長い光路による光損失を防ぐため、入射レンズ1122、リレーレンズ1123、出射レンズ1124を含むリレーレンズ系からなる導光手段1121が設けられ、これを介して青色光が青色光用ライトバルブ100Bに入射される。各光変調装置により変調された3つの色光はダイクロイックプリズム1112に入射する。このプリズムは4つの直角プリズムが貼り合わされ、その内面に赤光を反射する誘電体多層膜と青光

を反射する誘電体多層膜とが十字状に形成されている。これらの誘電体多層膜によって3つの色光が合成されて、カラー画像を表す光が形成される。合成された光は、投射光学系である投射レンズ1114によってスクリーン1120上に投射され、画像が拡大されて表示される。

【0182】図36に示すパーソナルコンピュータ1200は、キーボード1202を備えた本体部1204と、液晶表示画面を形成する電気光学装置100とを有する。

【0183】本発明は、上述した各実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う電気光学装置の製造方法或いは電気光学装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施形態の電気光学装置における画像表示領域を構成するマトリクス状の複数の画素に設けられた各種素子、配線等の等価回路である。

【図2】第1実施形態の電気光学装置におけるデータ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図である。

【図3】図2のA-A'断面図である。

【図4】図2のB-B'断面図である。

【図5】図2のC-C'断面図である。

【図6】第1実施形態及び第3実施形態で用いられる1H反転駆動方式における各電極における電位極性と横電界が生じる領域とを示す画素電極の図式的平面図である。

【図7】第1実施形態でTN液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図である。

【図8】第1実施形態で、VA液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図である。

【図9】第1実施形態の電気光学装置の製造プロセスを順を追って示す工程図である。

【図10】本発明の第2実施形態の電気光学装置におけるデータ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図である。

【図11】図10のA-A'断面図である。

【図12】図10のB-B'断面図である。

【図13】図10のC-C'断面図である。

【図14】第2実施形態及び第4実施形態で用いられる1S反転駆動方式における各電極における電位極性と横電界が生じる領域とを示す画素電極の図式的平面図である。

【図15】第3実施形態の電気光学装置におけるデータ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図である。

【図16】図15のA-A'断面図である。

【図17】図15のB-B'断面図である。

【図18】図15のC-C'断面図である。

【図19】第3実施形態における盛上り部の各種の断面形状を示す断面図である。

【図20】第3実施形態における盛上り部の各種の断面形状を示す断面図である。

【図21】第3実施形態でTN液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図である。

【図22】第3実施形態でVA液晶を用いた場合の液晶分子の配向の様子を示す図式的断面図である。

【図23】第3実施形態の電気光学装置の製造プロセスを順を追って示す工程図である。

【図24】第3実施形態における対向基板上に形成される盛上り部と遮光膜との平面レイアウトの各種具体例を示す一の平面図である。

【図25】第3実施形態における対向基板上に形成される盛上り部と遮光膜との平面レイアウトの各種具体例を示す他の平面図である。

【図26】図26は、本発明の第4実施形態の電気光学装置におけるデータ線、走査線、画素電極等が形成されたTFTアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図である。

【図27】図26のA-A'断面図である。

【図28】図26のB-B'断面図である。

【図29】図26のC-C'断面図である。

【図30】第5実施形態における走査線及び容量線が延びる部位の断面図である。

【図31】第6実施形態における走査線及び容量線が延びる部位の断面図である。

【図32】各実施形態の電気光学装置におけるTFTアレイ基板をその上に形成された各構成要素と共に対向基板の側から見た平面図である。

【図33】図30のH-H'断面図である。

【図34】本実施形態を用いた電子機器の実施例である。

【図35】本実施形態を用いた応用例としての投射型表示装置の実施例である。

【図36】本実施形態を用いた応用例としてのパーソナルコンピュータの実施例である。

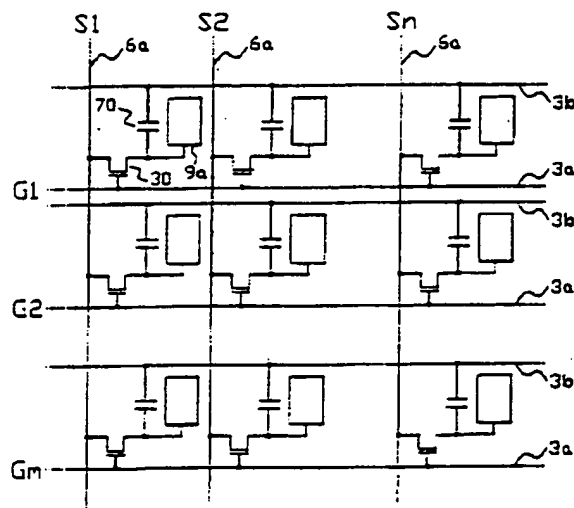
【符号の説明】

- 1a…半導体層
- 1a'…チャネル領域
- 1b…低濃度ソース領域
- 1c…低濃度ドレイン領域
- 1d…高濃度ソース領域
- 1e…高濃度ドレイン領域
- 1f…第1蓄積容量電極
- 2…絶縁薄膜
- 3a…走査線
- 3b…容量線

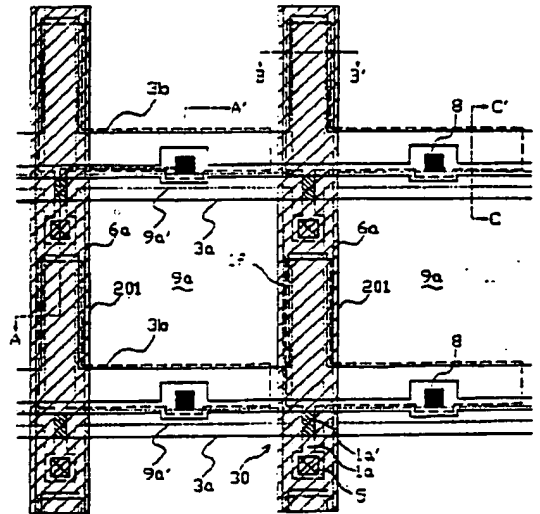
4…第1層間絶縁膜
 5…コンタクトホール
 6a…データ線
 7…第2層間絶縁膜
 8…コンタクトホール
 9a…画素電極
 10…TFTアレイ基板
 12…下地絶縁膜
 16…配向膜
 20…対向基板

21…対向電極
 22…配向膜
 23…遮光膜
 30…TFT
 50…液晶層
 50a…液晶分子
 70…蓄積容量
 201、202…溝
 301、302、303、304、305、306、307…盛上り部

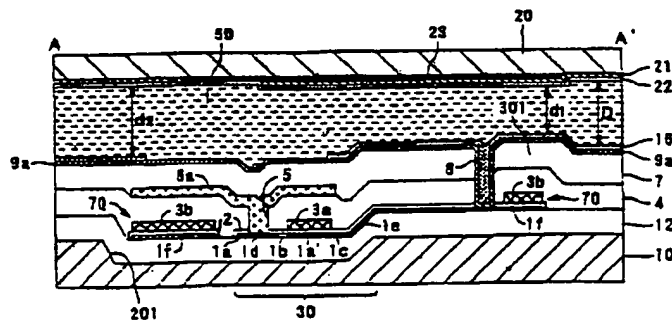
【図1】



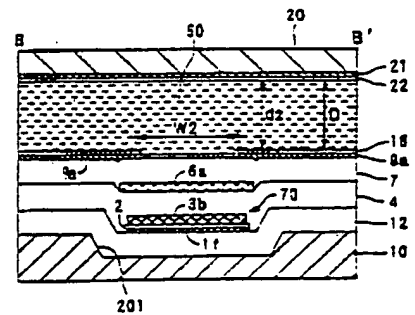
【図2】



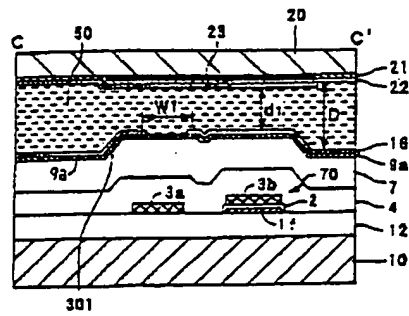
【図3】



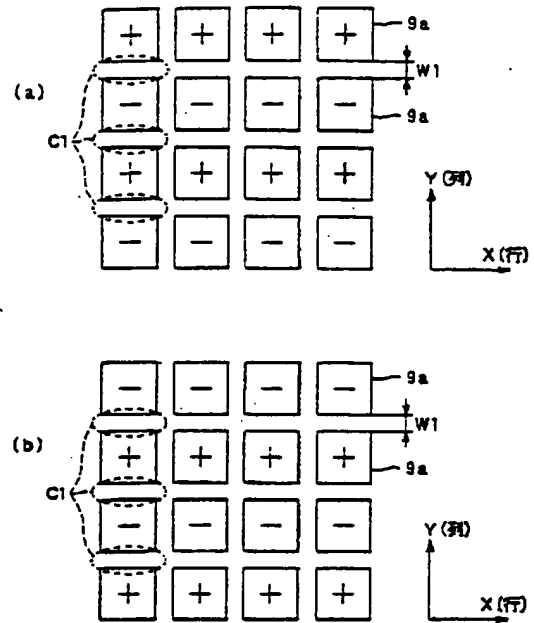
【図4】



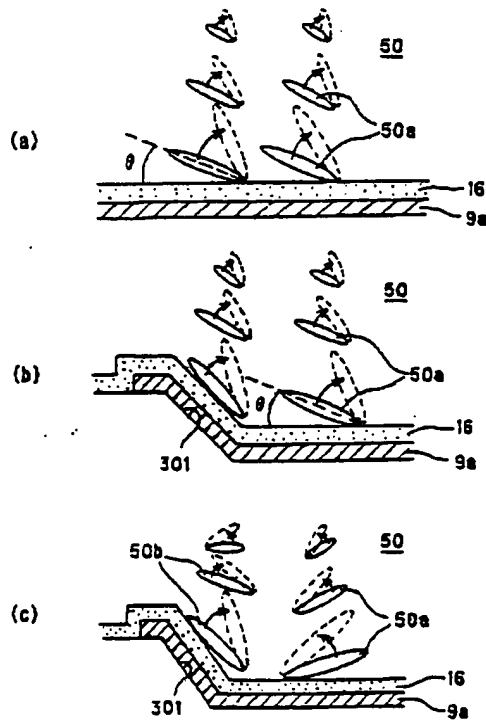
【図5】



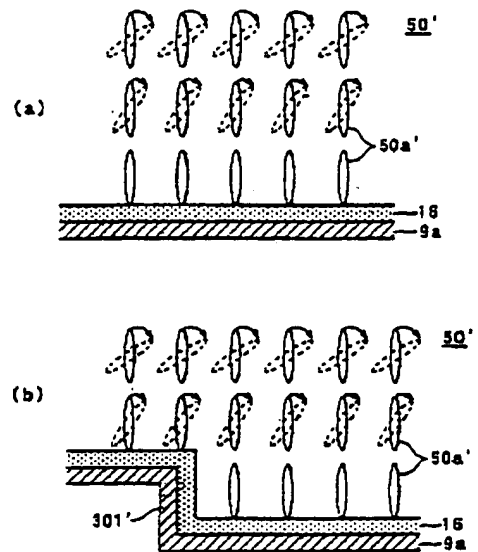
【図6】



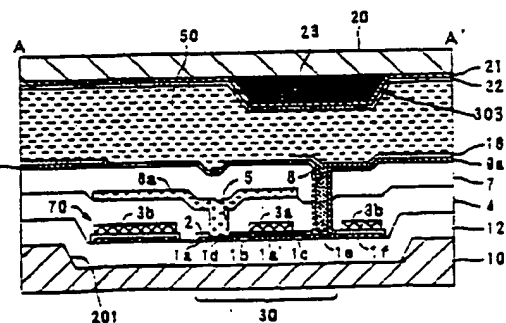
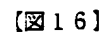
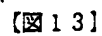
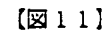
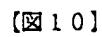
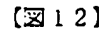
【図7】



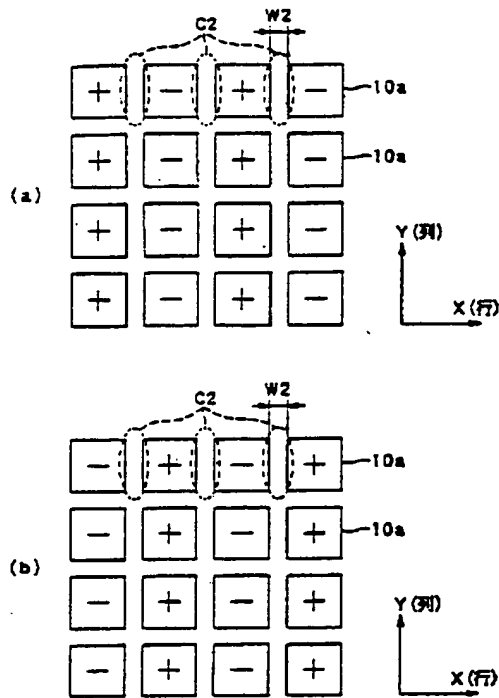
【図8】



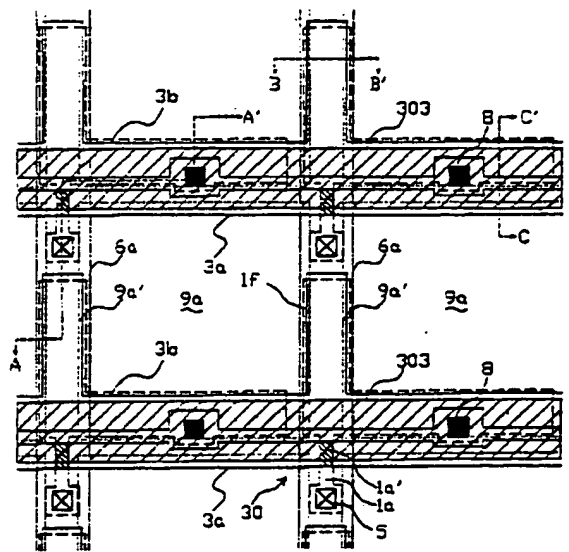
【图 9】



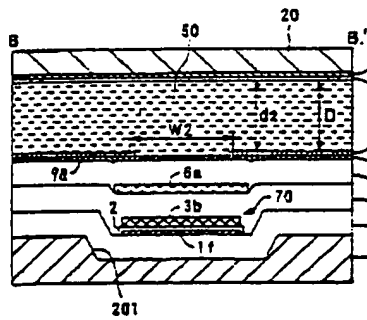
【図14】



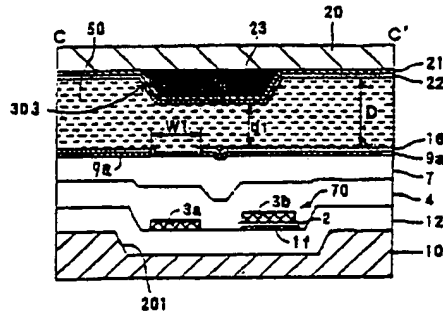
【図15】



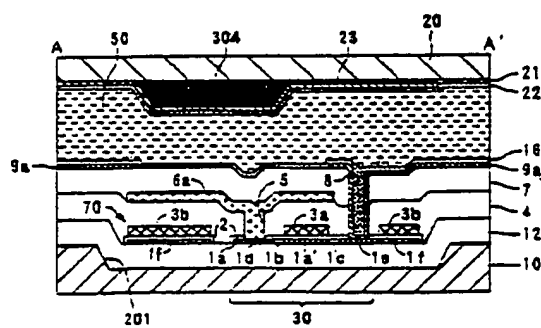
【図17】



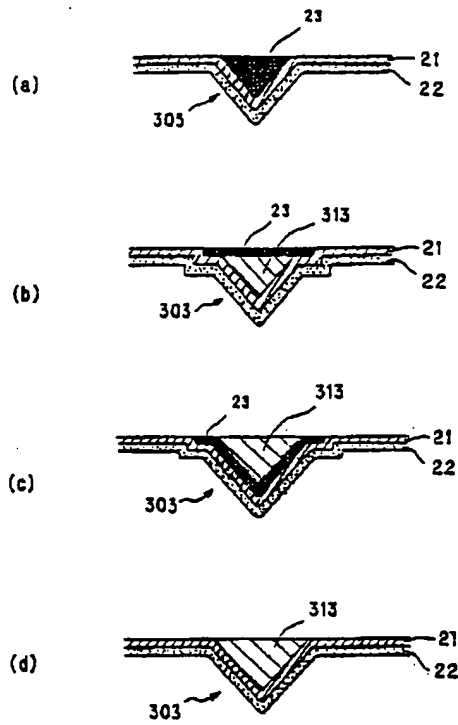
【図18】



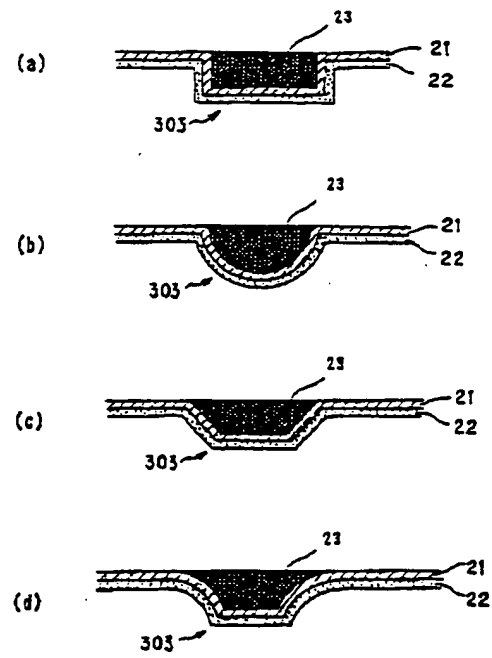
【図27】



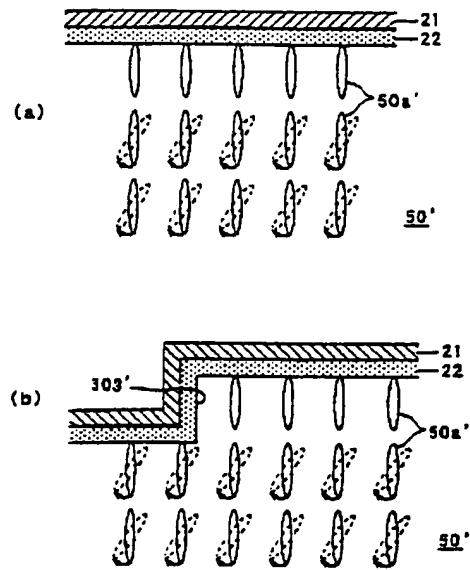
【図19】



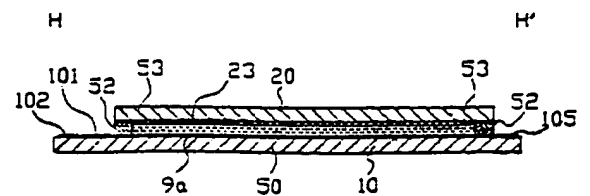
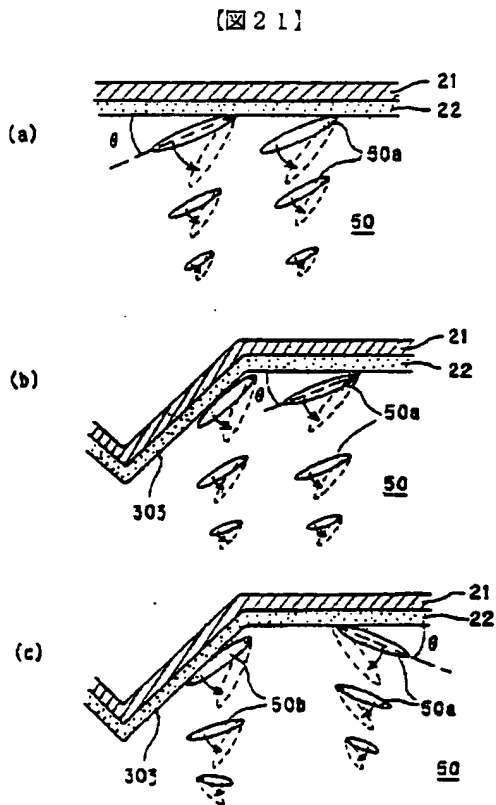
【図20】



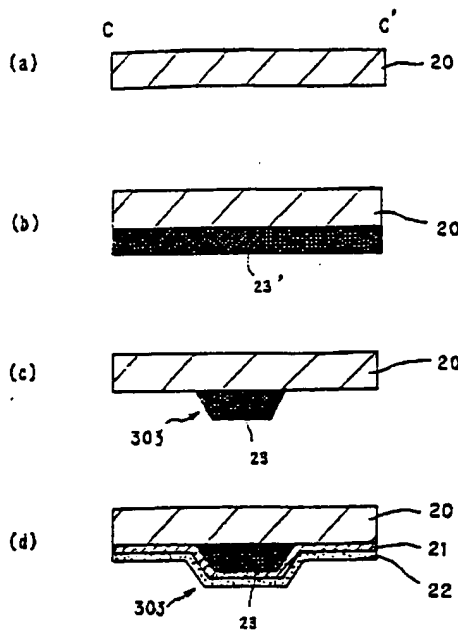
【図22】



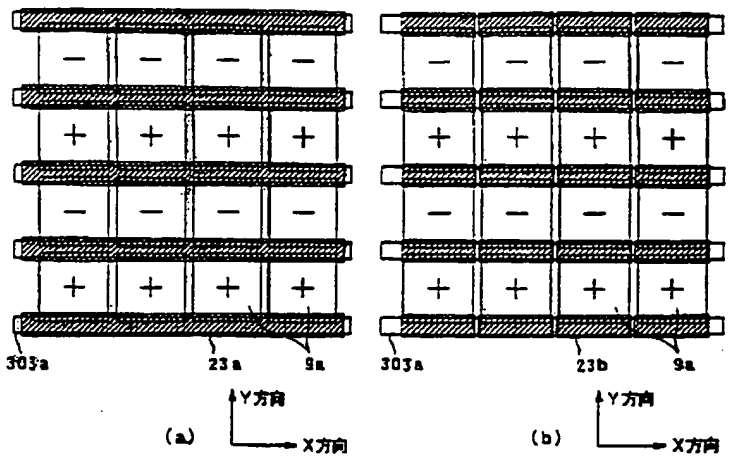
【図33】



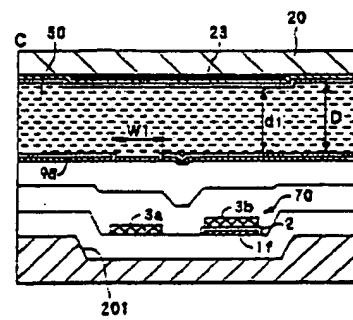
【図23】



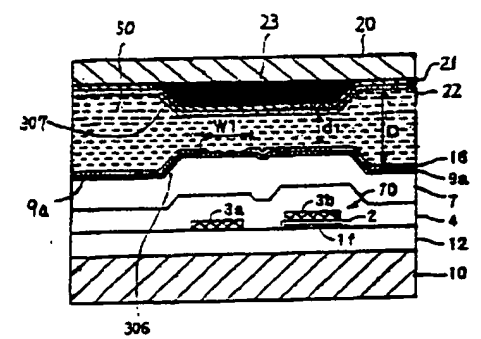
【図24】



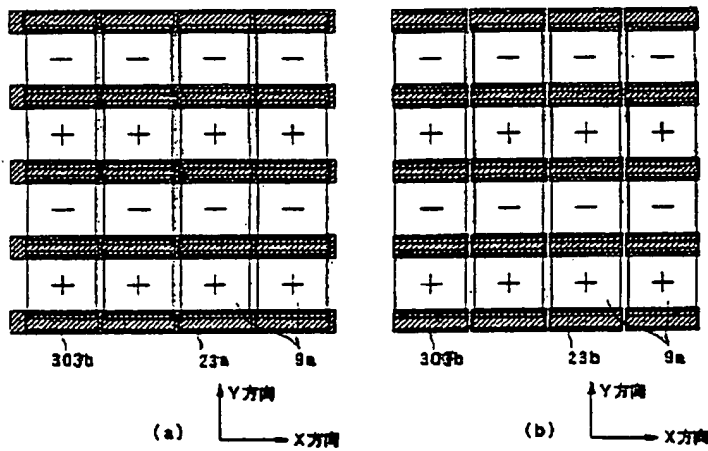
【図29】



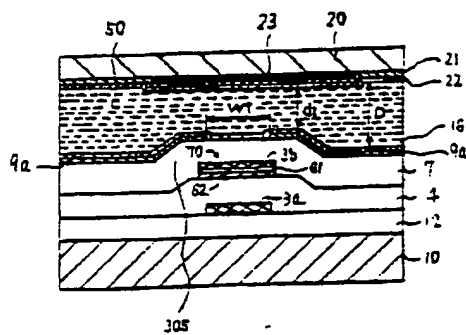
【図31】



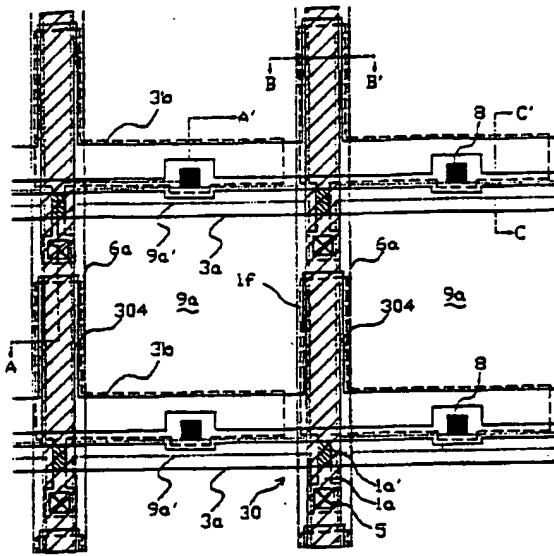
【図25】



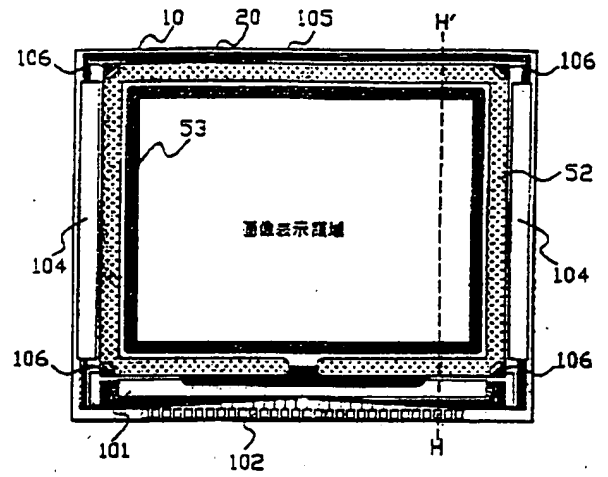
【図30】



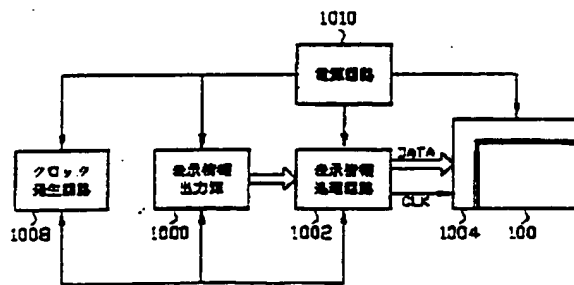
【図26】



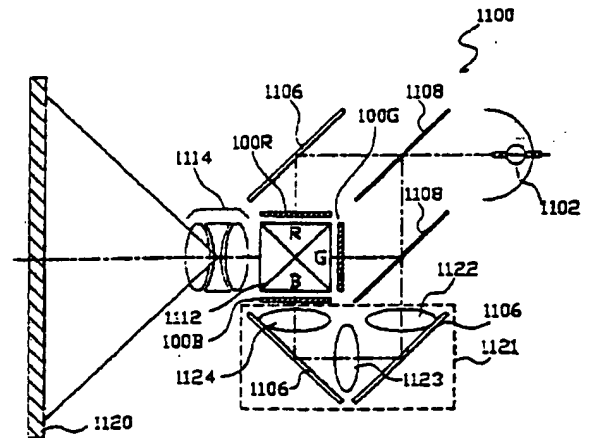
【図32】



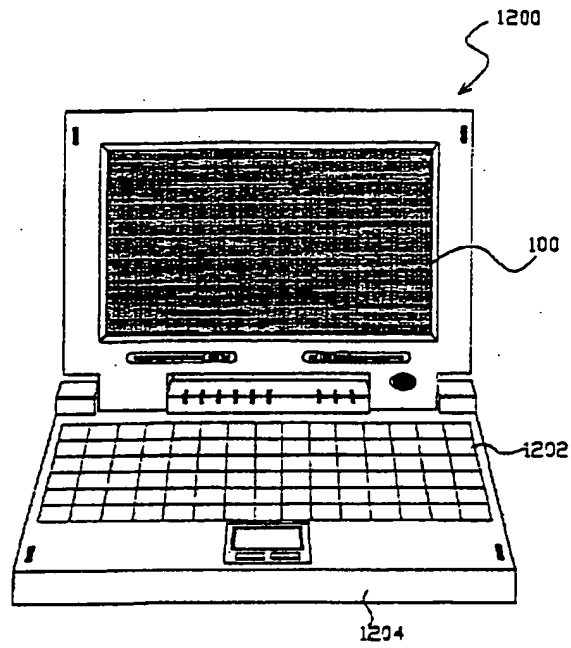
【図34】



【図35】



【図36】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

G 0 9 G 3/20

識別記号

6 2 1

6 2 2

6 8 0

F I

G 0 9 G 3/20

テ-マ-ド* (参考)

6 2 2 M

6 8 0 C

6 8 0 H

3/36

3/36

G 0 2 F 1/136

5 0 0